博士学位論文

氏名(本籍)	呉向容(台湾)				
学位の種類	博 士 (工学)				
学位記番号	甲 152 号				
学位授与年月日	平成 31 年 3 月 31 日				
学位授与の要件	学位規則第4条第1項				
学位論文題目	金属錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射による 機能性酸化物薄膜形成				
論文審查委員	主查 佐藤 光史				
	副査 大倉 利典				

工学院大学大学院

鷹野

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

一朗

湯本 敦史(芝浦工業大学教授)

博士論文要旨

「金属錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射による機能性酸化物薄膜形成」 化学応用学専攻

呉 向容

薄膜は 1 µm以下の厚さで,電気的機能や光学的機能などの多様な性質を材料表面に付与できること から,特に安定な金属酸化物が広く研究されている。薄膜を形成するには多様な方法があり,気相法と 液相法に大別できる。前者は 1)原子,分子レベルに分解した原材料を,2)基板まで輸送し,3)基 板表面に堆積する 3 過程からなり,煩雑なメンテナンスを欠かせない高価な真空装置を要する一方,不 純物や膜厚の制御,材料選択の自由度に優れており,半導体分野を中心に利用されている。一方,液 相法は真空装置が不要で,より安価な製造装置によって,大面積基板や複雑な形状の表面に均一薄 膜を形成可能である。

本論文で着目した液相法の一つである分子プレカーサー法は,安定な金属錯体のアルキルアンモニウム 塩を含むプレカーサー溶液を用いる。その溶液を基板に塗布したのち乾燥させて,金属錯体を含有する非 晶質のプレカーサー膜を形成する。そのプレカーサー膜を,空気または不活性ガス中で熱処理して結晶化し た薄膜を形成する。分子プレカーサー法は,他の液相法と異なり,熱処理前のプレカーサー膜を基板から 水洗除去できる点や塗布溶液の安定性などが大きな特徴である。

Blair らは、基板上に塗布した白金(II)アジ化メチル錯体を含む膜に紫外線を照射して、シリコン基板 上への白金膜形成を 1994 年に報告した。この光化学反応による薄膜形成は、化学結合を切断できる 高エネルギーな光の照射による有機物分解メカニズムによっている。この方法では、錯体膜への部分的な 光照射で場所選択的に光化学反応させることができ、光で細線を描くリソグラフィーと同じように、パターニ ング膜形成が容易である。また、光照射は低温でも可能なことから、耐熱性に乏しい基材上にも成膜でき る。近年、液相法による塗布膜への紫外光照射でPt膜が形成され、またTiO₂、PbTiO₂、Cu₂O、GeO₂、 LaMnO₃、AZrO_{3-X} (A = Ba, Ca, Sr)、ITO、ZTO、In₂O₃、IZO、IGZO や Bi₂O₃の金属酸化物膜 が形成されているものの、酸化物膜の結晶化には熱処理が用いられてきた。

本論文では、254 nm に最大波長をもつ殺菌ランプを使用し、分子プレカーサー膜への光照射による 金属酸化物薄膜形成を試みた。結果的に、銅(II)およびチタン(IV)錯体を含有する適切なプレカーサー 溶液の調製と、その塗布・乾燥したプレカーサー膜の形成、および紫外光照射による変化過程を調べ、 前者においてはパターニングについても検討した。

本論文は、全六章からなる。第一章には、本研究の背景を記載した。第二章は、銅(II)錯体含有プ

レカーサー膜への紫外光照射による Cu₂O 多結晶膜の室温下での形成とパターニングについて,また Cu₂O 多結晶膜の熱処理によって p 型半導体が得られることを実証して記載した。第三章は,熱処理を 伴う典型的な分子プレカーサー法を用いて形成した Cu₂O 薄膜の p 型 TFT への応用可能性を探索して 記載した。第四章は,石英ガラス基板上のチタン(IV)錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射による親 水性の非晶質薄膜形成について,また形成薄膜への紫外光照射で超親水性を誘起できることについて 記載した。第五章は,第四章と同じプレカーサー膜をポリカーボネート基板上に形成し,紫外光照射によ る超親水性非晶質薄膜の形成について記載した。第六章は,室温下での紫外光照射による金属酸化 物薄膜の形成を総括し,今後の展開を記載した。

第二章 銅(II)錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射による Cu2O 多結晶薄膜形成とパターン化

先に本研究室では、有機多座配位子の銅(II)錯体を含むプレカーサー溶液を石英ガラス基板上に塗 布、乾燥して得たプレカーサー膜を一定流量の Ar を通じた管状炉内で熱処理し、p型 Cu₂O 薄膜の形 成を報告した。本研究では、銅(II)のプロピルアミンとエチレンジアミンの混合配位子錯体を含む新たなプレ カーサー膜への紫外光照射によって、Cu₂O 多結晶薄膜形成を達成した。さらに、照射時にプレカーサー 膜の一部分は、紫外光が遮蔽されるようにしてパターン形成を試みた。その結果、遮光部分を水洗によっ て除去して、Cu₂O 薄膜のパターン形成に成功した。これは、プレカーサー膜中の安定な錯体は、ゾル-ゲ ル法の原理である含金属イオン成分の加水分解せずに存在し、かつ水溶性を保っていることを利用したも ので、パターニングに水洗を用いた初めての例である。紫外光照射で形成した膜をさらに熱処理して得た Cu₂O 薄膜の電気抵抗率、キャリア濃度、ホール移動度は、それぞれ 1.4(2) × 10² Ω cm、8(3) × 10¹⁶ cm⁻³、0.9(3) cm² V⁻¹ s⁻¹を示した。

第三章 分子プレカーサー法による p 型 Cu2O 薄膜の形成と薄膜トランジスタへの応用可能性

現在の液晶パネルの多くが使用している駆動素子は、半導体層にアモルファスシリコン(a-Si)を用い た薄膜トランジスタ(TFT)である。a-Si TFT はスイッチング特性に優れており、携帯電話などの小型ディ スプレイから 30 型を超える大型液晶テレビまで幅広く応用されている。また、半導体層を a-Si から InGaZnO4(IGZO)にすると、電子の移動度が約 20~50 倍高くなることが 2004 年に発見され、酸 化物半導体による TFT が活発に研究されている。そのほとんどは、電子帯が主に酸素の 2p 軌道からなる n 型酸化物半導体を用いた TFT である。その理由は、p 型酸化物半導体の形成が難しいためで、結果 として金属酸化物を用いて CPU やメモリーに用いられる CMOS 回路(n 型とp 型の両酸化物 TFT 半導 体層を相補的に配置した回路)を作成することも一般に困難である。CMOS 回路は,省電力で駆動す る電子回路として重要なものの,その駆動には 0.1 cm² V⁻¹s⁻¹以上の電界効果移動度が必要であり, それ以上のホール移動度をもつ p 型酸化物薄膜が必須である。本章では,シリコン基板上に銅(II)錯体 含むプレカーサー膜を塗布,熱処理して p 型 Cu₂O-TFT の作成を試み,On-Off 比が 26.5 の TFT を 得た結果を示した。また,デバイスの I-V 曲線が p 型 TFT の特性を示したので,現状をまとめて記載した。

第四章 チタン(IV)錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射による非晶質薄膜形成と超親水性

酸化チタンの光触媒反応と表面親水化が報告され、セルフクリーニングや防曇の機能について研究されている。本研究室でも、分子プレカーサー法を用いてチタン(IV)錯体を含むプレカーサー膜を熱処理し、高い光応答性をもつ酸化チタン薄膜の形成を先に報告した。

第二章で、銅(II)錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射による Cu₂O 多結晶薄膜形成を達成した。 本章では、石英ガラス基板上に塗布したチタン(IV)錯体含有プレカーサー膜に 2~16 時間まで紫外光を 照射して薄膜形成を試みた。得られた非晶質の薄膜は、160~170 nm の膜厚で、可視光領域で 80%以上の透過率を示した。また、鉛筆試験(ひっかき法)によって、薄膜の基板への密着性が 6H に 達していることを確かめた。XPS による分析結果は、Ti に結合している O と Ti の比が 1.53 であることを示 した。IR スペクトル(ATR 法)の経時変化から、紫外光は side-on 配位のペルオキソ基やシュウ酸イオ ン、アルキル基を含むプレカーサー膜を室温下で段階的に分解し、プレカーサー膜は 4 時間の照射で配位 子のほとんどを失ったことが分かった。

形成薄膜に成膜時と同じ紫外光を10分間照射すると、膜表面と水の接触角は4°以下の超親水性 を示し、暗所放置によって低下する親水性が紫外光の再照射で回復する機能も確認して記載した。さら に、超親水性の起源について、表面形態の観点から考察した。

第五章 非晶質酸素欠損チタニア薄膜によるポリカーボネート板の表面修飾

ポリカーボネート(PC)板は,高い耐衝撃性と可視光透過性をもつ安価な材料として多用されている。 また,紫外線領域の光を吸収することから,紫外線カット材料として使用した例もあり,屋外での利用が 多い。しかし,PC板は,太陽光や紫外線を含む光を長時間照射すると劣化して変色する。第四章では, ガラス基板上に形成したチタン(IV)錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射が,ガラスに良く密着し,か つ可視光域で透明な一方,275 nmより短波長の紫外光を効率的に吸収する超親水性非晶質薄膜を 室温下で形成するために有効なことが分かった。本章では,PC板上にチタン(IV)錯体含有プレカーサー溶 液を塗布,乾燥した膜に紫外線を室温下で照射し,非晶質薄膜の形成による表面修飾を試みた。その 結果,PC板に非晶質薄膜を形成した表面は,水滴との接触角が5°以下の超親水性を紫外光で誘起 できることが分かった。さらに,紫外光を三日間連続照射しても,非晶質薄膜を形成したポリカーボネート は明確には変色しなかった。一方で,PC板単独の参照試料が黄変したことから,形成した薄膜はPC板 の紫外光に対する保護膜として有効なことが分かった。

第六章 まとめ

各種デバイスが使用している気相法による薄膜は、欠陥が少なく高性能である一方で、高価で形成に 際するエネルギー消費量も一般に大きい。液相法は、低廉で単純な方法なものの、基板への密着性や 機能性に問題があった。従来の分子プレカーサー法はこれらのいくつかの問題を解決し、また他の液相法に 比べて比較的低温で膜形成を可能とするものの、結晶化に際して熱処理が必要だった。

本研究は、プレカーサー膜への紫外光照射による薄膜形成を試みた。先にプレカーサー溶液中に含まれ る銅(II)錯体を設計し、このプレカーサー膜への紫外光照射で Cu₂O 多結晶薄膜を形成した。これまでに、 光照射のみで結晶性の酸化物薄膜を形成した例は無かった。また、分子プレカーサー法の特徴を活かして、 遮光部分のプレカーサー膜を水洗し、薄膜のパターン化を達成した。形成した Cu₂O 薄膜の熱処理によっ て、 p 型半導体として期待される機能性薄膜材料を得ることができた。また、チタン(IV)錯体を含むプレ カーサー膜への室温下での紫外光照射により、光誘起超親水性非晶質薄膜を形成した。4 時間の紫外 光照射で得た 170 nm 厚の薄膜は、高い可視光透過率と低屈折率、また石英ガラス基板への高密着 性をもち、光誘起超親水性を示した。

本論文は、2 種類の金属イオン種について、いずれも薄膜プレカーサー膜に含まれる金属錯体の電荷 移動(CT)遷移を利用して、結晶性または非晶質の金属酸化物薄膜形成の研究を扱い、形成薄膜 に優れた機能を発現させることができた。このように本研究は、室温下での紫外光照射による薄膜形成や 水洗によるパターン化という従来の成膜概念を超える分子プレカーサー法の新たな特徴を開発できた。

博士学位論文

金属錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射による機能性酸化物薄膜形成

化学応用学専攻 呉 向容

博士論文 目次

- 1-1 研究背景
 - 1-1.1 金属酸化物薄膜の機能と応用
 - 1-1.2 薄膜の形成法
 - 1-1.3 分子プレカーサー法
 - 1-1.4 光照射による薄膜の形成と光化学反応
 - 1-1.5 核形成または結晶成長させるエネルギー
- 1-2 研究目的
- 1-3 実験方法
 - 1-3.1 使用試薬
 - 1-3.2 基板
 - 1-3.3 膜形成装置
- 1-4 測定装置
 - 1-4.1 X線回折装置
 - 1-4.2 走查型電子顕微鏡
 - 1-4.3 原子間力顕微鏡
 - 1-4.4 赤外・可視・紫外線吸収透過スペクトル法
 - 1-4.5 屈折率測定
 - 1-4.6 ラマン分光法
 - 1-4.7 赤外線分光法
 - 1-4.8 X 線光電子分光法
 - 1-4.9 ホール効果測定
 - 1-4.10 接触角測定
 - 1-4.11 鉛筆硬度試験
- 1-5 参考文献

第二章 銅(II)錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射による Cu2O 多結晶薄膜形成とパターン化…………22

- 2-1 研究背景と目的
- 2-2 実験方法
 - 2-2.1 [Cu(H₂EDTA)]·H₂Oの錯体粉末の調製
 - 2-2.2 EDTA 配位銅(II) 錯体含有プレカーサー溶液 SED の調製
 - 2-2.3 アルキルアミンが配位した銅(II)錯体含有プレカーサー溶液 Spの調製
 - 2-2.4 EDTA の銅錯体を含有するプレカーサー膜形成と紫外光(254 nm)照射
 - 2-2.5 混合アミン配位子をもつ銅錯体含有プレカーサー膜の形成と紫外光(254 nm)照射によるパターニング
 - 2-2.6 混合アミン配位子を含む銅錯体含有プレカーサー膜への紫外光(365 nm) 照射
 - 2-2.7 紫外光(254 nm) 照射で形成した薄膜の光電流密度測定
 - 2-2.8 紫外光照射による原料の銅金属塩の変化

2-3 測定結果

- 2-3.1 膜の XRD パターン
- 2-3.2 膜の吸収スペクトル
- 2-3.3 プレカーサー膜 Foと紫外光照射した膜 Fxの FT-IR スペクトル
- 2-3.4 F'6の電気的特性と膜厚
- 2-3.5 F₀, F₆, F₆ と F'₆ の FE-SEM 観察結果
- 2-3.6 紫外光照射した膜 FFTO6 の光電流密度測定

2-4 結果·考察

- 2-4.1 低温でのプレカーサー膜中の銅(II)錯体の構造変化
- 2-4.2 低温での銅(II)錯体の紫外光照射による酸化銅(I)の結晶成長
- 2-4.3 銅(II)錯体からなる固相 Cu2O の形成
- 2-4.4 水を除去剤に用いた酸化銅(I)のパターニング
- 2-4.5 EDTA 配位子, プロピルアミンとエチレンジアミンの混合配位子銅錯体, および銅金属塩, の紫外光照 射による分解

- 2-4.6 パターン化酸化銅(I)薄膜のアルゴン雰囲気中での熱処理効果
- 2-4.7 紫外光照射後に熱処理した酸化銅(I)薄膜 F'6の電気的性質
- 2-5 まとめ
- 2-6 参考文献
- 第三章 分子プレカーサー法によるp型Cu2O薄膜の形成と薄膜トランジスタへの応用可能性…………………50
- 3-1 研究背景と目的
- 3-2 実験方法
 - 3-2.1 [Cu(H₂EDTA)]·H₂Oの錯体粉末の調製
 - 3-2.2 銅(II)錯体含有プレカーサー溶液の調製
 - 3-2.3 薄膜とTFTの形成
- 3-3 測定結果
 - 3-3.1 形成した膜の XRD パターン
 - 3-3.2 F'_{0.2P}, F'_{0.3P}, F'_{0.6P}とF'_{0.3PH80}のTFT デバイス特性測定
 - 3-3.3 F'_{0.2P}, F'_{0.3P}, F'_{0.6P}とF'_{0.3PH80}のTFT デバイスの表面状態と膜厚
- 3-4 結果·考察
 - 3-4.1 銅(II)錯体含有プレカーサー膜を熱処理による p型 Cu₂O TFT の形成
 - 3-4.2 Cu₂O TFT デバイスの特性への膜厚による効果
 - 3-4.3 フォトリソグラフィから形成した薄膜の構造への影響
- 3-5 まとめ
- 3-6 参考文献
- 第四章 チタン(IV)錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射による非晶質薄膜形成と超親水性……………57
- 4-1 研究背景と目的
- 4-2 実験方法
 - 4-2.1 シュウ酸水素ブチルアンモニウム半水和物の合成
 - 4-2.2 シュウ酸を配位子とするプレカーサー溶液(STi)の合成

- 4-2.3 プレカーサー膜 Foと254 nm 紫外光照射膜 Fxの形成
- 4-2.4 紫外光照射膜 F4の水中浸漬処理と熱処理
- 4-2.5 プレカーサー膜 Fo に 365 nm の紫外光を 16 時間照射した膜 F365-16
- 4-2.6 254 nm の紫外光照射膜 FFT016 の光電流密度測定

4-3 測定結果

- 4-3.1 プレカーサー溶液 STiの吸収スペクトル
- 4-3.2 プレカーサー膜 Foと紫外光照射膜 Fxの光学的特性
- 4-3.3 紫外光照射膜 F4の水中浸漬処理と熱処理した後の透過スペクトル
- 4-3.4 プレカーサー膜 Foと F365-16, F365-16Pの吸収スペクトル
- 4-3.5 プレカーサー膜 Foと 254 nm の紫外光を照射した膜 Fxの XRD パターン
- 4-3.6 F₀, F_xと石英ガラス基板の FT-IR スペクトル
- 4-3.7 紫外光照射した膜 F4の XPS スペクトル
- 4-3.8 紫外光照射した膜 Fxの表面状態と膜厚, 密着性試験
- 4-3.9 紫外光照射した膜 Fxの水滴接触角
- 4-3.10 紫外光照射膜 FFT016 の光電流密度測定

4-4 結果·考察

- 4-4.1 オキサラトとペルオキソ混合配位チタン(IV)錯体を含有するプレカーサー膜
- 4-4.2 低強度紫外光照射による Ti(IV) 錯体を含むプレカーサー膜のチタニア薄膜への変換
- 4-4.3 アモルファス薄膜の光学的および機械的特性
- 4-4.4 アモルファス薄膜の光誘起超親水性
- 4-5 まとめ
- 4-6 参考文献

- 5-1 研究背景と目的
- 5-2 実験方法
- 5-3 測定結果

- 5-3.1 紫外光照射した薄膜と基板の透過スペクトル
- 5-3.2 紫外光照射で形成した薄膜の結晶構造
- 5-3.3 紫外光照射で形成した薄膜の表面状態とスクラッチ強度
- 5-3.4 紫外光照射で形成した薄膜の接触角実験
- 5-4 結果·考察
 - 5-4.1 低強度紫外光照射によるポリカーボネート板上に Ti(IV)錯体塩を含むプレカーサー膜の非晶質薄膜への形成
 - 5-4.2 FPCx の紫外光カット特性
 - 5-4.3 **F_{PCx}の表面状態とスクラッチ強度**
- 5-5 まとめ
- 5-6 参考文献
- 6-1 湿式法による機能性膜の形成の現状
- 6-2 紫外光照射による薄膜の形成
- 6-3 今後の方針

研究業績 90

謝辞

第一章

研究背景と目的

1-1 研究背景

1-1.1 金属酸化物薄膜の機能と応用

薄膜は 1 マイクロメートル以下の厚さからなり, 電気的, 磁気的, 光学的機能などの多様な性質を材料表面 に付与できる。薄膜材料の中でも金属酸化物は, 安定な材料として幅広く研究されている。例えば, 図 1 が示し たように, TiO2 は光応答性酸化物半導体材料として色んな方向に応用された。また, 酸化物半導体薄膜は, トランジスタ (InGaZnO [1], SnOx [2], ZnO [3], Cu_xO [4,5]), 光触媒 (TiO₂ [6], Cu_xO [7]), 透明導電膜 (Indium Tin Oxide(ITO), FTO, GaZnO, AlZnO), 太陽電池 (Cu₂O [8], ZnO, TiO₂ [9]), セルフクリーニング膜 (TiO₂, WO₃) などへの応用が期待されている。また, 誘電体 (SiO₂, MgO, ZrO₂ [10], Al₂O₃, ZrTiO₄ [11]) やハードコート (SiO₂, CeO₂, ZrO₂), 他にも超電導材料 (YBa₂Cu₃O₇₋₅ [12]), 圧電材料 (PdZrTiO₃ [13]), ガスセンサー (SnO₂) への応用も研究されている。 薄膜のメリットは, 次のように機能化, 小型化, 低コストの三点が挙げられる。**機能化**; 薄膜を対象物質に付加 することによって, 波長の選択性, 電気伝導性, 耐衝撃性, 耐候性, 耐汚性という機能の付与が可能である。 **小型化**; 形成膜は, デバイスを作製する基板の厚さに比較して無視できる程度に薄い。したがって, 基板の形状 にほぼ影響を与えないことから, デバイスの薄型化、小型化が可能である。**低コスト**; 薄膜を対象物質表面に付 与することによって, バルク体に同じ機能をもたせることができる。薄膜は, 使用する原材料の量はバルク体に比較し て少ないことから省資源である。また, 形成に必要なエネルギーも, 機能性材料をバルク体として成型加工すること に比較して一般に削減できる。



Figure 1 Applications of TiO₂ based on it's electrical, optical, and photocatalytic properties [14].

1-1.2 薄膜の形成法

このような機能性薄膜の形成法は、真空を要する気相法と溶液を用いる液相(湿式)法に大別でき、前世 期に発展した半導体産業での成膜は主に前者が担ってきた。気相法は、固体または液体の原料を多種多様なエ ネルギー(例:熱、衝撃、超音波など)で、原子または分子レベルまでチャンバー中に気体状に分散させ、基 板上に原子や分子を蒸着させて薄膜を形成する。さらに気相法は、固体原料を熱やプラズマのエネルギーで気化し て基板上に蒸着させる物理的気相蒸着(Physical Vapor Deposition, PVD)と、薄膜の構成元素を含む 気体を原料として、基板表面との化学反応で薄膜を形成する化学的気相蒸着法(Chemical Vapor Deposition, CVD)の二種類に分けられる。図2に、気相法と液相法による薄膜の形成法についてまとめた。



Figure 2 Various methods for thin film fabrication.

その中の PVD は、ターゲットを均一な気相状態にするためにチャンバー内を高真空環境にする必要がある。大量 生産する場合、大型な真空チャンバーと高真空環境が必要になるため、環境の制御やメンテナンスに相当な技術 やコストが必要である。 液相法は,最終生成物を形成するための前駆体溶液の基板表面での化学反応によって成膜する方法である。 電解メッキと無電解メッキは,基板の形状にとらわれることなく,低価格で成膜可能なことから工業的に利用されて いる。しかし,電解メッキは,浸漬した電解液にバイアスを印加するための導電性基板を必要とする。また,無電解 メッキは絶縁性基板にも適応できるものの,基板表面に触媒反応を用いて成膜することから,膜に不純物が残留 するという問題点が挙げられる。また,一般的にメッキで形成した膜の厚さは,数マイクロオーダーであり薄膜の定義 からは外れることが多い。

ゾルゲル法は、金属イオン含有有機系ポリマーを利用してガラスやセラミックスを形成するために開発された。有機 溶媒に可溶なアルコールや、アセチルアセトン、カルボン酸エステルと金属イオンとの化合物などの無機材料を原料と する。さらに、これらの化合物の加水分解を促進させる触媒として、酸や塩基を溶媒に添加して前駆体溶液を調 製する。その結果、溶液中の金属化合物が加水分解(hydrolysis)と縮合重合(polycondensation)を 起こして、ポリマーとコロイド粒子を生成する。さらなる溶液内反応によって細かい粒子が結合し、ゾルが水と溶媒を 含んだ状態で湿潤なゲルとして固化する。溶液が固化する前段階で、基板上に溶液を塗布するとゲルは基板上に 広がって膜状になる。図3に、ゾルゲル法の溶液調製プロトコールを示した。



Sol-gel method

Figure 3 Protocol of a conventional sol-gel method for SiO₂.

塗布する際には,溶液中に含有する水と溶媒が蒸発して,乾燥した多くは非晶質のゲル膜が形成される。この

ゲル膜を熱処理して膜内の有機物と残留物を除去すると、目的とする無機化合物または混成物、ガラス、セラミ ックスなどの膜を形成できる。一方、これらの膜を高結晶性に到達するための熱処理温度は理論的に高い。なぜな ら、ゲル化段階で形成された金属一酸素ネットワークを再配列するために、大きなエネルギーで金属一酸素結合 を切断または移動させることが不可欠だからである。また、ゾルゲル法は原理的に加水分解を用いており、水の共 存に不安定な化合物が原料である。結果的に、原料や溶液の不安定性が問題に成りがちなのは、その原理に基 づく欠点の一つである。

1-1.3 分子プレカーサー法

本論文で活用した分子プレカーサー法は,設計した金属錯体が,溶媒中に安定な状態で均一溶解しているプレカーサー溶液を調製し,金属や金属酸化物の薄膜を形成する方法である。

金属錯体は、金属イオンに配位子となるアンモニアや有機化合物が配位結合した化合物である。配位結合は、 金属イオンに結合する原子が、金属イオンの空軌道に電子対を提供して形成される。金属錯体は、可視紫外光 領域に特徴的な吸収帯をもち、d-d 遷移(d-d transition)と電荷移動遷移(Charge transfer transition)による (図4参照)。



Figure 4 Typical absorption spectrum of transition metal complex and assignment of the absorption bands

前者は, 吸収した光エネルギーによって金属イオン中の低エネルギーd 軌道 (d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}) に存在する電子 が, 高エネルギーd 軌道 (d_{x²-y²}, d_{z²}) に遷移する現象である (図5参照)。後者は, 吸収した光エネルギー によって, 金属イオンから配位子 (Metal to Ligand Charge Transfer, MLCT), または配位子から金属イオ ン (Ligand to Metal Charge Transfer, LMCT) に電子移動する現象である。後者は前者よりも高エネルギ ーを要し、一般にそれぞれ紫外光領域と可視光領域で起こる(図6参照)。一般的な金属錯体が着色しているのは、前者の電子遷移に起因していることが多い。



Figure 5 Shemetic diagram of d-d transition of an electron between splitted d orbitals.



Figure 6 Charge-transfer (CT) transition of electron in metal complex. Based on the transition direction of electron, CT transition can be categolized into (a) lignad-to-metal charge transfer (LMCT), and (b) metal-to-ligand charge transfer (MLCT).

分子プレカーサー溶液は、溶媒中の比較的安定な金属錯体または金属塩とアルキルアミンの酸・塩基反応によって調製される。得られた溶液は、生成した金属錯体の分子やイオンが溶媒中で均一に溶解しており、錯体が単 分散分子量を保っていることから、優れた均一性や塗布性、異種金属の混合性、安定性などの特徴をもつ。

分子プレカーサー法による薄膜の形成は、先ずスピンコート法で基板上に溶液を均一に塗布し、恒温乾燥器 中で溶媒を蒸発させて、金属錯体含有の非晶質なプレカーサー膜を形成する。そのプレカーサー膜を、空気または キャリアガス中での熱処理によって有機物などの配位子を燃焼・除去すると、金属イオンが反応しながら、結果的に 金属や金属酸化物の薄膜が形成する。

本研究室は, EDTA 配位子の銅(II)金属錯体含有のプレカーサー膜をアルゴンガス中 450°C の熱処理によっ て, p型 Cu₂O 薄膜が形成できることを先に報告した [15]。その Cu₂O 薄膜が高いキャリア移動度をもつことから, トランジスタへの応用が期待されている [16]。

また, EDTA 配位子のチタン(IV)金属錯体含有のプレカーサー膜をアルゴンガス中での 500°C での熱処理に続いて空気中 500°C の熱処理によって, 光応答性の高い酸素欠損アナターゼ型 TiO₂ 薄膜形成を報告した [17]。 さらに, このプレカーサー膜をアルゴンガス中 700°C で熱処理した酸素欠損ルチル型 TiO₂ 薄膜は, 可視光応答 性を発現するだけでなく, 紫外光照射によっても高い光反応活性を示した [18]。

これら本研究室が実施してきた研究は,酸素欠損がアナターゼ・ルチルを問わずに著しく光応答性を向上させる 事実に基づいて,永く不明だった TiO2 薄膜の光応答性発現の起源を化学的に明らかにしたことを示している。

1-1.4 光照射による薄膜の形成と光化学反応

従来の分子プレカーサー法やゾルゲル法は、基材上に塗布形成した前駆体膜を、熱処理する薄膜形成法である。1994 年, S. L. Blair らは、白金(II)アジ化メチル錯体への光化学反応によってシリコン基板上への白金膜の形成を報告した [19]。前駆体から目的化合物薄膜への光化学反応による形成は、分子中の化学結合エネルギーより高いエネルギーの光を前駆体に照射して、吸収させた光エネルギーによって化学結合を切断し、有機物を分解するプロセスによる [20]。また、物質に吸収された光のみが化学反応を起こし得るという光化学第一法則

(Grotthus- Draper 法則) によって,選択的な光化学反応を起こすことが可能である。これは,熱で起こる化 学反応との違いであり,光で細線を描くリソグラフィーの原理と同じである [21]。この光化学反応の特性から,膜 形成時にパターニングも可能と考えられる。さらに,光照射は低温環境でも可能なことから,非耐熱性の基材上へ の成膜も一般に可能である。 近年,多くの研究グループは,液相塗布膜への光照射で Pt [19,22], TiO₂ [23], PbTiO₂ [24], Cu₂O [25], GeO₂ [26], LaMnO₃ [27], AZrO_{3-X} (A = Ba, Ca, Sr) [28], ITO [29,30], ZTO [29], In₂O₃ [31], IZO [32], IGZO [33], と Bi₂O₃ [34]の金属や金属酸化物の機能性薄膜を報告している。これら報告 された成膜は、レーザーまたは紫外線ランプなどの光源を使用した。

レーザー(Light amplification by stimulated emission of radiation, Laser)は、単一波長のフォト ンを単一方向に集中して射出する発光デバイスである。用途に合わせて、レーザーのの照射強度を変える。薄膜形 成の分野では、レーザーアニール(Laser annealing)という工程がある。その原理は、高出力レーザーを照射し、 原子間の化学結合エネルギーより高いエネルギーで熱処理のように結合を切断し、有機残留物を除去して膜を形 成する。十分な照射強度であれば、熱処理より低温な雰囲気中で、目的化合物の結晶化も可能である。しかし、 大面積基板に対する光照射は、レーザーの特徴から困難である。また、高出力レーザーの扱いは、装置制御と環 境の十分な管理が必要である。

水銀ランプは,基本的に三種類の中心波長をもつ。185 と 254 nm に中心波長をもつランプは,主にオゾン 洗浄の発生装置に使われている。先ず,185 nm の光に照射された酸素分子が酸素原子に分解し,オゾンを生 成する。生成したオゾンに 254 nm の光を照射すると,活性酸素が生成する。生成した活性酸素は炭素に結合 しやすく,生成物も CO₂ などの揮発性物質である。

また、オゾンと水の共存下において紫外線照射すると、次式にしたがって OH ラジカルが生成する。

$$O_3 + hv (\lambda < 310 \text{ nm}) \rightarrow O (^1D) + O_2 (^1\triangle_g)$$
(1.1)

$$O(^{1}D) + H_{2}O \rightarrow 2OH$$
(1.2)

人工的に生成したオゾンは、純水の殺菌、プール水浄化、冷却塔のレジオネラ対策や半導体などの電子部品 の洗浄、フォトレジスト(Photo resistor)膜の剥離などの用途で工業的に応用されている [35]。この光源は、 光化学反応による成膜の分野でかなり魅力的な装置であるが、OH ラジカルなどの活性酸素種が過剰な環境は 人体に対して危険である。これらの活性種は、脂質、たんぱく質、酵素、DNA や RNA などの生体物質を攻撃 し、細胞または神経、筋肉組織の破損によって人体に変性疾患を起こす [36]。これらを防ぐために、使用環境 の十分な管理が必要である。

中心波長が 356 nm のランプは、半導体生産工程のフォトリソグラフィ(Photolithography)におけるフォト

レジストのパターニングに主に使用されている。

本研究では、254 nm に中心波長をもつ殺菌灯を使用した。殺菌灯は、低出力な一方で、殺菌には十分に 応用可能で、食品工場や薬品工場などで使用されている。また、出力が低い(約 4 mW cm⁻²)ことから、光 源装置の冷却は不要で、安価で長時間の連続使用が可能である。

1-1.5 核形成または結晶成長させるためのエネルギー

PVD法による膜形成は、初期反応としてターゲット原子を基板に吸着させ、膜の基となる核を形成する。その核 を中心に成長して、シート状の薄膜が形成される。単独のターゲット原子を膜までに成長させるためには、十分なエ ネルギーの供給が必要である。

成膜しながら同時に結晶化させるためには、部分的にでも原子と原子を一定方向の配列に移動させるエネルギ ーが必要である。一方、形成した非晶質膜を結晶化させる際は、原子間の結合を先ず切断し、再配列させるエ ネルギーが必要である。与えるエネルギーが不十分な場合や、原子が一定の方向に配列できない場合、または結 合の切断ができない場合は、結晶性が極端に低い結晶質かアモルファスの構造になる。外部から与えるエネルギー は、熱、光、電場、触媒などから供給できる。高温での熱処理は、簡単に膜を結晶化させることができるため最 も広く使用されているものの、非耐熱性のポリマー基板には適用できない。また、熱エネルギーは等方的に伝播する ため、特定の範囲のみを結晶化させることは難しい。

外部電場による膜形成は、electro-spray deposition や電解メッキで使用されている。電場を調整し、数十 nmの厚さの超薄膜も形成可能である。しかし、ターゲットと基板の間に電界を生成しながら、基板表面を帯電さ せないために、導電性基板上のみで膜形成可能である。無電解メッキは、触媒による化学反応で膜形成する (1.2 参照)。

本研究で使用した紫外光照射は赤外光を含まないため、非耐熱性の基板も使用可能である。また、光は直 進する性質を持つため、光遮断マスクを使用すると、微小範囲への選択的な照射が可能である。

表1に,薄膜形成時に使用する各種の成膜方法と,それらの特徴をまとめた。本研究で使用する紫外光は赤 外線を含まないため,低温環境での成膜が可能なことから,プラスチックなどの非耐熱基板も使用可能と考えられ る。また,1-1.4節に説明したように,光遮断マスクによる選択的な膜形成も期待される。

	Heat treatment	UV-irradiation	Electrical Bias	Catalyst
Type of energy	Heat	Photon	Electricity	Chemical energy
Applicable coating method	All	Coating of solution	Electroplating/ ESD	Electroless plating
Temperature	High	Low	Low	Low
Power required for processing	High	Low	Low (Electroplating) High (ESD)	Low
Limitation of substrate	Only for heat resistive substrate	Νο	Only for conductive substrate	No
Area selectivity	No	Yes (by using mask)	Depends on conductive area of substrate	No
Byproduct	Gas	Gas	No	Residual

 Table 1 Summary of differences between several methods for thin film fabrication.

1-2 研究目的

以上の背景のもとに、本論文は、安価な市販殺菌ランプを使用した分子プレカーサー膜への紫外光照射によって、2 種類の金属酸化物からなる機能性薄膜の形成を試みた。このために、銅(II)とチタン(IV)錯体を含有する プレカーサー溶液を調製し、その溶液を塗布・乾燥したプレカーサー膜に紫外光を照射した。また、光化学第一法 則を活用して、膜への部分的光照射によるパターニングを検討した。

1-3 実験方法

第二章から第五章までの実験において共通で使用した試薬,基板や測定装置を本節に表記する。

1-3.1 使用試薬

使用試薬を表2にまとめた。

 Table 2 Reagents used in this research.

物質名称	化学式または略号*1	F.W.	製造会社
2-プロパノール	IPA	60.10	大成化学
31%過酸化水素水	31% H ₂ O ₂	34.01	三徳化学
アセトン	ace	58.08	大成化学
エタノール*2	EtOH	46.07	上野化学工業
ギ酸銅四水和物	Cu(HCOO) ₂ ·4H ₂ O	225.64	和光純薬工業
酢酸銅一水和物	Cu(CH ₂ COO) ₂ ·H ₂ O	199.65	関東化学
エチレンジアミン四酢酸	EDTA	292.24	関東化学
チタンテトライソプロポキシド	TTIP	284.22	関東化学
プロピルアミン	PrNH ₂	59.11	和光純薬工業
エチレンジアミン	en	60.10	関東化学
ブチルアミン	BuNH ₂	73.14	和光純薬工業
シュウ酸二水和物	H ₂ ox	126.07	関東化学

チタンテトライソプロポキシドは, 有機合成試薬を, それ以外は, 特級を使用した。

*1本論文は、これらの略号を用いる。

*2 エタノールは,使用前にモレキュラーシーブス(4A)を用いて脱水した。他の物質は,精製することなく使用した。

1-3.2 基板

シリコン基板; 第三章では, 熱酸化 SiO2 層付き n 型シリコン基板 (SUMCO Co.) を 15 × 15 × 0.5

mm³ にダイシングソー装置で切断して使用した。切断前,基板表面にフォトレジスト TMSR をスピンコート法で塗布(3000 rpm-30 s)し,120°C のホットプレート上で5分間乾燥して保護膜を形成した。保護膜付きシリコン基板は,10 mLのアセトン中で15分間超音波洗浄後,さらに10 mLの IPA 中で15分間の超音波洗浄を2回行った。洗浄済みの基板は、マッフル炉中、500°Cで10分間熱処理して有機物を燃焼除去し、常温まで冷却して使用した。

石英ガラス基板; 第四章は, 両面研磨した石英ガラス基板(有限会社昭島硝子工業)を 20 × 20 × 1.5 mm³に切断して使用した。石英ガラス基板は, クリーンエース (アズワン株式会社) で 15 分間超音波洗浄 後, スポンジで洗った。洗剤を水で洗い流し, 100 mL の純水中で 15 分間超音波洗浄を2回行った。洗浄済 みの基板は, IPA で保管し, 成膜前に 70°C で 10 分間乾燥させた後, 常温まで冷却してから使用した。

無アルカリガラス基板; 第四章では, 両面研磨した無アルカリガラス基板(有限会社昭島硝子工業)を20 × 20 × 1.1 mm³に切断して使用した。これらの基板は, クリーンエース (アズワン株式会社)で15分間超音波洗浄後, スポンジで洗った。洗剤を水で洗い流し, 100 mL の純水中で15分間の超音波洗浄を2回行った。洗浄済みの基板は, IPA 中で保管し, 成膜前に70°C で10分間乾燥させた後, 常温まで冷却して使用した。

ポリカーボネート板基板; 第五章では, ポリカーボネート板基板(タキロンシーアイ株式会社) を 20 × 20 × 1 mm³に切断して使用した。ポリカーボネート板基板は, 10 mL の IPA 中で 15 分間の超音波洗浄を 2 回行った。洗浄済みの基板は, 成膜前に 70°C で 10 分間乾燥させた後, 常温まで冷却して使用した。

1-3.3 膜形成装置

本研究では、スピンコート法(KYOWARIKEN スピンコーター K-359S1)のダブルステップモードを用いて、 金属錯体を含有するプレカーサー液を基板上に均一塗布した。塗布条件は、第二章から五章まで同一で、プレカ ーサー溶液を基板中心部に滴下し、第1ステップは500 rpmで5s間で、第2ステップは2000 rpmで30 s間スピンさせた。得られた膜を70°Cの定温乾燥器(DRE320DB, ADVANTEC)中で10分間乾燥してプレ カーサー膜を形成した。殺菌灯(GL-15, Panasonic)からの紫外光照射による薄膜の形成については、詳細な 条件を各章に記録した。紫外光照射前に、基板表面に到達する紫外線強度を紫外線強度計 UVC-254 (SATO SHOUJI INC.)で測定して、殺菌灯と基板表面の距離を調整した。

膜の熱処理は、石英管状炉(EPKRO-12K, ISUZU)の中心に膜を置き、一方からキャリアガスを流しなが ら行った。キャリアガスの流量は、各章に記録した。 1-4 測定装置

1-4.1 X 線回折装置 (X-Ray Diffraction, XRD)

XRD(SmartLab, Rigaku, Japan)は、出力 45 kV × 200 mA の Cu-*K*a(1.541 Å)線を試料 に照射し、検出した回折パターンを測定した。回折パターンは、X 線入射角度を 0.3°、速度 5.0° min⁻¹、角 度ステップ 0.05°で、20 範囲が 10~80°を測定した。

結晶子サイズは、式(1.3)で表す Debye-Scherrer 法で測定した。D, B, $\lambda \geq \theta$ は、結晶子サイズ、結晶 子の大きさによる回折線の広がり、測定X線波長 (Cu Ka)、ひずみと回折線のブラッグ角を表す。Kはscherrer 定数の 0.9 を使用した。

$$\mathsf{D} = \frac{\kappa \lambda}{\beta \cos \theta} \tag{1.3}$$

1-4.2 走查型電子顕微鏡 (Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM)

FE-SEM(JSM-6701F, JEOL)は、発生電子を試料表面または断面に照射し、検出器に反射した電子の エネルギーで観察写真を記録した。出力 5 kV × 10 μ A の電子銃で試料に照射して観察した。電気導電性が 低い試料の表面観察を容易にするために、Quick Coater(SC-701 MkII ECO, Sanyu Electron, Japan) を用いて金を1分間蒸着した。対象とした試料は、第二章に記載した F_0 、 F_6 、 F_{6P} 、 F'_6 、第四章に記載した F_2 、 F_4 、 F_8 、 F_{16} 、と第五章に記載した F_{PC4} 、 F_{PC8} 、 F_{PC16} である。

SEM は、細く絞った電子線を走査しながら試料に照射し、試料表面から放出された 2 次電子を検出器に引き 込んで計測し、その発生量によって 2 次元の像を得る装置である。試料の凹凸によって 2 次電子線の発生量が異 なるため、発生量を反映させることによって間接的な 3 次元像が得られる。ヘアピン型のタングステンフィラメントから の熱電子を発生させる電子線源があるが、今回使用した線源は電界放出(FE = Field Emission)型である。 これは、ケイ素(シリコン)のチップに電界を印加して電子を発生させる方式で、電子線をより細く絞れるために高 分解能観察(高倍率)が可能である。

1-4.3 原子間力顕微鏡(Atomic-Force Micrometer, AFM)

AFM(NaioAFM, NanoSurf)は、ダイナミック法で面積 10 × 10 µm²の範囲で試料の表面形状を測定

した。測定に際しては、背面に金薄膜付きの探針を微小な力で試料の表面に接触し、試料をX,Y軸方面に移動しながら、半導体レーザーを探針の背面に照射し、反射した光を光変位検出器(Position Sensitive Detector, PSD)で検出した。この時、各x,y座標に対する探針のz軸方向の変動を取り込み、画像処理によって試料表面の三次元形状に対応したイメージに転換した。

1-4.4 近赤外・可視・紫外線吸収透過スペクトル法(NIR-Vis-UV spectrophotometer)

吸収・透過分光器(U-2800 spectrophotometer, Hitachi)を用いて, 試料と標準試料に平行ビーム法 で同時に照射し, 透過光を検出器で測定した。波長掃引速度 200 nm min⁻¹ に設定し, 波長範囲 200~ 1200 nm のスペクトルを測定した。セル長または試料長は, 溶液試料の場合に1 mm, また薄膜試料では 10 mm とした。

1-4.5 屈折率測定(Refractive index measurement)

屈折率測定装置(MARY-102 scanning ellipsometer, Five Lab, Japan)は, 632.8 nm の He-Ne レーサービームを試料表面に照射し,反射光を検出して屈折率を測定した。レーザー光入射角度は 70.07°とし, 14 箇所の測定を3回行って測定結果の平均を計算した。14 箇所の測定を5回ずつ行った結果の最高および最 低値を除き,残りの3回ずつの結果を平均した。

1-4.6 ラマン分光法(Raman spectroscopy)

ラマン分光法装置(NRS-2000, JASCO, Japan)は、出力 50 mW の 532 nm のレーザー光を試料表面に照射し、ラマン散乱光を CCD(Charge-Coupled Device)カメラで測定した。ラマンシフト範囲は 80~
 4000 cm⁻¹まで測定し、180 s 間の照射を 10 回積算してスペクトルを得た。

骨格が対称伸縮振動を示す分子に対して,振動数 v₀の光を照射して振動電場を与えると,分極率(原子 や分子がもつ電荷分布の相対的な偏り)が変化する。ラマン分光法は,このような分子に単色の可視,紫外光 線を照射した際に,分子の分極率が変化するラマン散乱光が観察できる原理を用いている。すなわち,ラマン分光 法は,分極率変化を起こす分子振動による吸収を測定するために,対称伸縮振動をもつ物質にのみ有効である。 下記する赤外線分光法と相補的に用いられる。

1-4.7 赤外線分光法(Fourier-Transform Infrared Spectra, FT-IR)

FT-IR 装置(FT-IR-4600, JASCO, Japan)は、ATR(Attenuated Total Reflection)法を用いて、 赤外光を試料と KBr プリズムの間に数回反射させて、最後に射出した光を検出器で測定した。波数範囲 500~ 4000 cm⁻¹を測定し、126 回積算してスペクトルを得た。毎回の測定前に、試料なしに KBr プリズムのみで測 定し、ノイズの CO₂を除去して校正した。

赤外吸収分光法は,双極子モーメントの変化を起こす振動による吸収を観測することから,逆対称伸縮振動と 変角振動をもつ物質のみに有効である。一般に,二つの振動が互いに打ち消しあう時,赤外線を吸収しないので, 観察できない(例;直線状分子の CO2の対称伸縮振動)。一般に,振動によって双極子モーメントが変化する 分子から,照射光と同じ振動数の光が放射されるので,その赤外光を観測する。

1-4.8 X 線光電子分光法 (X-Ray Photoelectron Spectroscopy, XPS)

XPS 装置(Phi Quantum 2000 Scanning ESCA Microprobe, JEOL, Japan)は、単色光の Al Ka X線(1486.6 eV)を試料に照射して、検出器に反射してきた目標元素の各軌道に存在していた電子のエネル ギーを検出してスペクトルを得た。各化学結合エネルギーシフトは、C 1s を 284.5 eV に校正し、分解能は 0.1 eV だった。

試料に照射した X 線は, 試料表面から約 10 μm から 1 mm 程度の深さまで侵入し, 構成原子から電子を 放出させる。しかし, 固体中の電子は平均自由行程が小さく, 固体の外部に放出される電子はその一部である。 1,000 eV の運動エネルギーをもつ電子の平均自由行程は, 金属中で 0.5-2 nm, 酸化物中で 1.5-4 nm で, 運動エネルギーが小さければさらに短くなる。したがって, XPS では固体表面から数ナノメートルの距離までの情 報のみが得られる。

X線源のターゲットとしてマグネシウムまたはアルミニウムを用い,これに加速電子線を照射して生じた X線を試料 に照射し,試料から飛び出した電子の運動エネルギー分布を測定する。試料中の原子に存在する電子は,X線 のエネルギーを吸収して原子核からの束縛(結合エネルギー)をのがれ,余剰エネルギーを運動エネルギーとして飛 び出す。したがって,関係式(1.1)で表すことができる。

(結合エネルギー, eV) = (X線のエネルギー, eV) - (運動エネルギー, eV) (1.1)

ここで結合エネルギーは, 真空での値を基準としたものである。マグネシウムとアルミニウムをターゲットとする X 線管

が発する Ka放射 X 線エネルギーは、それぞれ 1253.6 と 1486.6 eV であり、それ以下の結合エネルギーのみを 測定できる。結合エネルギーは、元素と軌道に依存する固有の値を持つので、元素分析が可能である。また、原 子の化学状態によってその値がシフトし、その原子の状態、特に荷電状態を知ることができるため、化学分析とし ても有用である。すなわち、原子の酸化状態(価数)によって結合エネルギーが変化する。より酸化された価数の 高いカチオンほど電子を強く束縛できるので、放射電子の運動エネルギーは小さくなり、観測される結合エネルギー は相対的に大きくなる。

論文内に示したすべての XPS スペクトルは, Gaussian 法でフィッティングした波形をソフトウェア(Origin, OriginLab, USA)を用いて処理した結果である。また, 各元素の定量分析は, 各元素に帰属できる結合エネ ルギーのピーク面積を求め, 当該元素の感度因子で除して計算した。本研究で使用した各元素の感度因子は, XPS ピーク分析ソフトウェア(SpecSurf, Version 2.0.2, JEOL)のデータベースから, 次の値を引用した。C 1s; 4.079, N 1s; 7.0415, O 2p; 10.9553, Ti 2p_{3/2}; 20.3181, Si 2p_{3/2}; 3.6039。

1-4.9 ホール効果測定(Hall effect measurement)

ホール効果測定装置(HL5500 Hall system, Accent, UK)は、四つの触針を試料表面の各角に置き、 電圧と磁場を印加して測定した。面積が約 5 × 5 mm² になるように切断した測定試料を 5 回測定して、平均 値と標準偏差を求めた。関係式(1.2)によって、電気抵抗率(σ)、キャリア濃度(n)とキャリア移動度(μ) を計算した。ここで、e は電子電荷である。

$$\sigma n\mu = 1/e \tag{1.2}$$

1-4.10 接触角測定(Contact angle measurement)

接触角の評価方法は、動的法と静的法に分類できる。動的法は、拡張/収縮法と滑落法を使用し、溶液が 試料表面に濡れ広がると収縮する時の接触角の変化を、または液滴付きの試料を水平状態から傾斜させて液滴 の接触角の変化と滑落挙動を観察して、試料表面の液除去性と溶液のコーティング性を評価する。本研究は、 静的法である液滴法を使用し、水平な試料表面に一定量の純水を接触させて接触角を測定し、試料表面の濡 れ広がり性を比較検討した。

接触角測定装置(FACE, KYOWA INTERFACE SCIENCE CO., LTD., Japan)は、 試料表面に 1.0

µL の純水を機械的に接触させて、カメラで側面から撮影した画像から、純水と試料表面の接触角度をソフトウェ ア (FAMAS, Interface Measurement & Analysis System Ver. 2.2.0, KYOWA INTERFACE SCIENCE CO., LTD., Japan)を用いて測定した。各試料について 3 回ずつ測定して、平均値と標準偏差を 求めた。

光照射による薄膜の親水化度の測定前に,各試料を 12 時間暗所放置した。また,薄膜への光照射は, 25°C,湿度 30-40%で,波長 254 nm と強度 4 mW cm⁻²の紫外線を 10 分間行った。

1-4.11 鉛筆硬度試験(Pencil scratching strength experiment)

鉛筆硬度試験は, 膜の硬度を鉛筆心の硬さと比較する簡易的な方法である。JIS no. K 5600-5-4 にしたが って, 硬さ9Hから6Bまでの鉛筆 (Mitsu-Bishi, UNI, Japan) で試料表面に一定の力で5回直線を引いた。 引いた箇所に消しゴムを数回当てて汚れを除去し, 膜表面に観察できる鉛筆跡の有無を調べた。試料表面に 3 本以上の痕跡が観察できるまで, 鉛筆の硬さを段階的に柔らかくして試験し, 痕跡が 2 本以下の場合に当該硬 度とした。

1-5 参考文献

- Kamiya, T.; Nomura, K.; Hosono, H. Present status of amorphous In–Ga–Zn–O thin-film transistors. *Sci. Technol. Adv. Mater.* 2010, *11*, 044305.
- Fortunato, E.; Barros, R.; Barquinha, P.; Figueiredo, V.; Park, S.H.K.; Hwang, C.S.; Martins, R.
 Transparent p-type SnO_x thin film transistors produced by reactive rf magnetron sputtering followed by low temperature annealing. *Appl. Phys. Lett.* **2010**, *97*, 052105.
- [3] Yapabandara, K.; Mirkhani, V.; Sultan, M.S.; Ozden, B.; Khanal, M.P.; Park, M.; Wang, S.;
 Hamilton, M.C.; Chung, Y.; Kim, D.-J.; Sk, M.H.; Study of device instability of bottom-gate ZnO transistors with sol–gel derived channel layers. *J. Vac. Sci. Technol. B* 2017, *35(3)*, 03D104.
- [4] Jang, J.; Chung, S.; Kang, H.; Subramanian, V.; P-type CuO and Cu₂O transistors derived from a sol-gel copper (II) acetate monohydrate precursor. *Thin Solid Films* 2016, 600, 157–161.
- [5] Sanal, K.C.; Vikas, L.S.; Jayaraj, M.K. Room temperature deposited transparent p-channel CuO thin film transistors. *Appl. Surf. Sci.* 2014, 297, 153–157.
- [6] Tang, B.; Chen, H.; Peng, H.; Wang, Z.; Huang, W.; Graphene Modified TiO₂ Composite Photocatalysts: Mechanism. *Nanomaterials* 2018, *8*, 105.
- [7] Senevirathna, M.K.I.; Pitigala, P.K.D.D.P.; Tennakone, K. Water photoreduction with Cu₂O quantum dots on TiO₂ nano-particles, *J. Photochem. Photobio. A Chem.* **2005**, *171*, 257–259.
- [8] Ergen, O.; Gibb, A.; Vazquez-mena, O.; Regan, W.R. Metal insulator semiconductor solar cell devices based on a Cu₂O substrate utilizing h-BN as an insulating and passivating layer. *Appl. Phys. Lett.* 2015, 106, 103904.
- [9] Suleiman, A.B.; Abdullahi, S.S.; Ndikilar, C.E.; Isiyaku, S. Fabrication of ZnO/Cu₂O and TiO₂/Cu₂O
 Heterojunction Solar Cell Using Spray Pyrolysis Method. *Int. J. Adv. Res.* 2017, *5(12)*, 1834–1841.
- [10] Gong, Y.; Zhao, K.; Yan, L.; Wei, W.; Yang, C. Ning, H. Room Temperature Fabrication of High Quality ZrO₂ Dielectric Films for High Performance Flexible Organic Transistor Applications. *IEEE Electron device letters* 2018, 39(2), 280–283.
- [11] Kim, T.; Oh, J.; Park, B. Hong, K.S. Correlation between strain and dielectric properties in Correlation between strain and dielectric properties in ZrTiO₄ thin films. *Appl. Phys. Lett.* 2003, 76,

3043.

- [12] Benzi, P.; Bottizzo, E.; Rizzi, N. Oxygen determination from cell dimensions in YBCO superconductors, J. Cryst. Growth. 2004, 269, 625–629.
- [13] Tsujiura, Y.; Suwa, E.; Nishi, T.; Kurokawa, F.; Hida, H.; Kanno, I. Airflow energy harvester of piezoelectric thin-film bimorph using self-excited vibration. *Sensors and Actuators A* 2017, 261, 295–301.
- [14] Nakata, K.; Fujishima, A. TiO₂ photocatalysis: Design and applications, *J. Photochem. Photobio. C Photochem. Rev.* 2012, *13*, 169–189.
- [15] Nagai, H.; Suzuki, T.; Hara, H.; Mochizuki, C.; Takano, I.; Honda, T.; Sato, M. Chemical fabrication of *p*-type Cu₂O transparent thin film using molecular precursor method, *Mater. Chem. Phys.* 2012, 137, 252–257.
- Pattanasattayavong, P.; Thomas, S.; Adamopoulos, G.; Mclachlan, M.A.; Thomas, D.; Mclachlan, M.A.; Anthopoulos, T.D. *p*-channel thin-film transistors based on spray-coated Cu₂O films. *Appl. Phys. Lett.* 2013, *102*, 163505.
- [17] Nagai, H.; Mochizuki, C.; Hara, H.; Takano, I.; Sato, M. Enhanced UV-sensitivity of vis-responsive anatase thin films fabricated by using precursor solutions involving Ti complexes, *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* 2008, 92, 1136–1144.
- [18] Nagai, H.; Aoyama, S.; Hara, H.; Mochizuki, C.; Takano, I.; Baba, N.; Sato, M. Rutile thin film responsive to visible light and with high UV light sensitivity, *J. Mater. Sci.* 2009, 44, 861–868.
- Blair, S.L.; Hutchins, J.; Hill, R.H.; Bickley, D.G.; Solid-state photochemistry of platinum(II) methylazide complexes as thin films on Si (111) surfaces: photolithography of platinum films, *J. Mater. Sci.* 1994, 29, 2143–2146.
- [20] Bretos, I.; Jiménez, R.; Ricote, J.; Calzada, M.L. Low-temperature crystallization of solution-derived metal oxide thin films assisted by chemical processes, *Chem. Soc. Rev.* **2018**, *47*, 291–308.
- [21] 光化学協会,光化学の事典,朝倉書店,日本,2015, pp.84。
- [22] Zhang, J.-Y.; Boyd, I.W. Photo-induced decomposition of platinum metalorganic films for electroless copper plating, J. Mater. Sci. Lett. 1997, 16, 996–998.

- [23] Hattori, A.; Tokihisa, Y.; Tada, H.; Tohge, N.; Ito. S.; Hongo, K.; Shiratsuchi, R.; Nogami, G.
 Patterning effect of a sol-gel TiO₂ overlayer on the phtocatalytic activity of a TiO₂/SnO₂ bilayer-type photocatalyst. *J. Sol-Gel Sci. Tech.* 2001, *22*, 53–61.
- [24] Calzada, M.L.; González, A.; Poyato, R.; Pardo, L. Photo-sensitive sol-gel solutions for the lowtemperature UV-assisted processing of PbTiO₃ based ferroelectric thin films. *J. Mater. Chem.* 2003, *13*, 1451–1457.
- [25] Buono-Core, G.E.; Tejosr, M.; Klahn, A.H.; Cabello, G.; Lucero, A.; Hill, R.H. Solid state photochemistry of Cu(II) alkyltropolonate complexes in thin films: The photochemical formation of high quality films of copper(I) oxide, *J. Chil. Chem. Soc.* 2007, *52*, 1318–1321.
- [26] Que, W.; Jia, C.Y.; Sun, M.; Sun, Z.; Wang, L.L.; Zhang, Z.J.; Inorganic Hybrid Sol-Gel Films for Photonic Applications, *Opt. Express.* 2008, *16*, 489–493.
- [27] Nakajima, T.; Tsuchiya, T.; Ichihara, M.; Nagai, H.; Kumagai, T. Epitaxial Growth Mechanism for Perovskite Oxide Thin Films under Pulsed Laser Irradiation in Chemical Solution Deposition Process. *Chem. Mater.* 2008, 20, 7344–7351.
- [28] Cabello, G.; Lillo, L.; Caro, C.; Buono-Core, G.E.; Chornik, B.; Flores, M.; Carrasco, C.; Rodriguez,
 C.A. Photochemical synthesis of AZrO_{3-X} thin films (A=Ba, Ca and Sr) and their characterization,
 Ceram. Int. 2014, 40, 7761–7768.
- [29] Lim, H.S.; Rim, Y.S.; Kim, H.J. Photoresist-Free Fully Self-Patterned Transparent Amorphous Oxide Thin-Film Transistors Obtained by Sol-Gel Process, *Sci. Rep.* 2015, *4*, 4544.
- [30] Yoshimoto, Y.; Li, J.; Shimoda, T. Development of a direct patterning method for functional oxide thin films using ultraviolet irradiation and hybrid-cluster gels and its application to thin-film transistor fabrication, *Appl. Phys. Express.* **2018**, *11*, 046501.
- [31] John, R.A.; Chien, N.A.; Shukla, S.; Tiwari, N.; Shi, C.; Ing, N.G.; Mathews, N. Low-Temperature Chemical Transformations for High-Performance Solution-Processed Oxide Transistors, *Chem. Mater.* 2016, 28, 8305–8313.
- [32] Park, S.C.; Kim, D.; Shin, H.; Lee, D.K.; Zhang, X.; Park, J.; Choi, J.S. Advanced photo-annealing of indium zinc oxide films for thin-film transistors using pulse UV light, *J. Inf. Disp.* **2016**, *17*, 1–7.

- [33] Kim, Y.-H.; Heo, J.-S.; Kim, T.-H.; Park, S.; Yoon, M.-H.; Kim, J.; Oh, M.S.; Yi, G.-R.; Noh, Y.-Y.; Park, S.K. Flexible metal-oxide devices made by room-temperature photochemical activation of sol–gel films. *Nature*. 2012, 489, 128–132.
- [34] Pérez-Mezcua, D.; Bretos, I.; Jiménez, R.; Ricote, J.; Jiménez-Rioboó, R.J.; daSilva, C.G.;
 Chateigner, D.; Fuentes-Cobas, L.; Sirera, R.; Calzada, M.L. Photochemical solution processing of films of metastable phases for flexible devices: the β-Bi₂O₃ polymorph, *Sci. Rep.* 2016, *6*, 39561.
- [35] 吉田 隆, OHラジカル類の生成と応用技術,株式会社 エヌ・ティー・エス,日本,2008, pp.41-44。
- [36] Amarowicz, R.; Pegg, R.B.; Rahimi-Moghaddam, P.; Barl, B.; Weil, J.A. Free-radical scavenging capacity and antioxidant activity of selected plant species from the Canadian prairies, *Food Chem.* 2004, 84, 551–562.

第二章

銅(II)錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射 による Cu₂O 多結晶薄膜形成とパターン化 2-1 研究背景と目的

安価で無毒な酸化銅(I)は, p 型半導体デバイスへの利用が期待されている。酸化銅(I)のバンドギャップは 2.1-2.6 eVで [1],高いホール移動度と [2,3],高い吸収係数 [4]をもつため、多くの電子デバイスへの応用 がさまざまな作製方法で研究されてきた。2012 年,我々の研究室は化学的湿式法の分子プレカーサー法を用い て,p型酸化銅(I)薄膜を形成した液相法での最初の論文を発表した [5]。その方法では、エチレンジアミン四酢 酸(EDTA)配位子の銅(II)錯体を含有したプレカーサー溶液をガラス基板上に塗布して乾燥した後、Ar 雰囲気 の管状炉中で熱処理してp型酸化銅(I)薄膜を形成した。他の方法と同様に、このような結晶化した金属酸化物 膜の作製には、熱処理による非晶質前駆体の分解が必要だった。

一方, ゾルゲル法で作製されたゲル薄膜を紫外光照射で作製したセラミックス薄膜は, 多くの研究グループによっ て評価されてきた(第一章 1-1.4節)。また, Pt, TiO₂, GeO₂, ITO をパターニングした薄膜は, 各ゲル薄膜 を紫外光シールドで覆うことによって得られている。これらは, 紫外光シールドした箇所を有機溶剤で洗浄処理して 取り除かれてきた [6-11]。しかし, 紫外光シールドした箇所を純水洗浄によって, 薄膜をパターニングした報告 はない。さらに, Pt 金属と p 型酸化銅(I)を除いて, ゾルゲル法で作製された薄膜のほとんどが誘電体や n 型半導 体であり, p 型半導体特性を示す酸化銅(I)が評価された例はなかった [12]。

本研究では、銅(II)錯体のプレカーサー膜を室温で低強度の UV 光照射した p 型酸化銅(I)薄膜を評価した。 パターニングはプレカーサー膜に紫外光シールドのガラス基板を乗せることで作製した。紫外光シールドされた箇所は 水を使って取り除いた。

2-2 実験方法

2-2.1 [Cu(H2EDTA)]·H2Oの錯体粉末の調製

文献[5]にしたがって、以下のように調製した。500 mLビーカーに純水300 gを入れて75°Cに加熱した。11.7 g(40.0 mmol)のEDTAを撹拌しながら加え,白色懸濁液を得た。この溶液を75°Cに加熱撹拌し,8.00 g (40.0 mmol)の酢酸銅(II)一水和物を加え,75°Cを保ちながら1時間加熱撹拌して青色透明溶液を得た。 この溶液を室温まで放冷して,エバポレーターで約40 gまで減圧濃縮して結晶を析出させた。この結晶をろ紙 (ADVABTEC (No. 131))を用いて吸引ろ過し,純水で3回洗浄した。ドラフト内で一晩風乾して,12.33 g (収率;82.9%)の青色粉末を得た。

2-2.2 EDTA配位銅(II) 錯体含有プレカーサー溶液 SED の調製

銅(II)の EDTA 錯体含有溶液は、100 mL 三角フラスコに 5.00 g のエタノール、5.02 g (13.5 mmol) の[Cu(H₂EDTA)]·H₂O と 3.50 g (27.0 mmol) のジブチルアミンを入れ、一時間還流して室温まで放冷した。銅(II)のプロピルアンミン錯体は、スクリュー管ビンに 5.00 g のエタノール、2.10 g (9.30 mmol) のプロピル アミンと 2.20 g (37.20 mmol) のギ酸銅(II)四水和物を入れ、室温下で 1 時間撹拌した。調製した溶液に エタノールを加えて銅イオン濃度が 0.5 mmol g⁻¹ になるように希釈し、**S**_{ED} と表記した。**S**_{ED} の外観写真と溶液 中に含有が予想される銅(II)の EDTA 錯体の構造を図 1 に示した。



Figure 1 Photograph of the precursor solution S_{ED} , and the plausible structure of the Cu(II) complex of EDTA.

2-2.3 アルキルアミンが配位した銅(II)錯体含有プレカーサー溶液 Spの調製

5.00 g のエタノールに, 1.89 g (8.39 mmol) のギ酸銅(II)四水和物と0.99 g (16.78 mmol) のプロ ピルアミン, および 0.50 g (8.39 mmol) のエチレンジアミンを入れて撹拌し, 複合配位子錯体溶液を調製し た。次に, 室温で 2.10 g (9.30 mmol) のギ酸銅(II)四水和物と2.20 g (37.20 mmol) のプロピルアミ ンを混合して銅(II)錯体溶液を調製した。

上で調製したプロピルアミンとエチレンジアミンの複合配位子の銅(II)錯体とプロピルアミン配位子の銅(II)錯体の 溶液を 1 対 8 の物質量比で混合して、銅(II)錯体を含むエタノール溶液 S_p を調製した。調製した溶液 S_p の Cu^{2+} の濃度は 0.65 mmol g⁻¹で、プレカーサー溶液として使った。 S_P の外観と溶液中に含有することが予想され る銅(II)錯体の構造を図 2 に示した。また、次のようにワンポット合成を試み、 S_{P1} を得た。3.00 g のエタノールに、 0.63 g (2.77 mmol) のギ酸銅(II)四水和物と 0.62 g (10.47 mmol) のプロピルアミン、および 0.02 g (0.31 mmol) のエチレンジアミンを入れて撹拌して調製した。調製した溶液 S_{p1} の Cu^{2+} の濃度は S_p と同様に 0.65 mmol g^{-1} とした。



Figure 2 Appearance of the precursor solution S_P , and the proposed structures of the mixed Cu(II) complexes with propylamine and ethylenediamine.

2-2.4 EDTA の銅錯体を含有するプレカーサー膜形成と紫外光(254 nm)照射

マイクロピペットを使用して, 無アルカリガラス基板上に 100 µL のプレカーサー溶液 **S**_{ED}を滴下した。2 段階スピンコート法(1 段階: 500 rpm で 5 秒, 2 段階: 2000 rpm で 30 秒)で塗布し 70°C の乾燥機中で 10 分間乾燥したものをプレカーサー膜 **F**_{ED0} とした。

F_{ED0}を,温度が30-40°Cで湿度を50-60%としたクリーンベンチ内で,殺菌灯(波長が254 nm,光強 度が4 mW cm⁻²からの紫外光を8,16,および32 h 照射した。形成した膜は,**F**_{ED8},**F**_{ED16}および**F**_{ED32} と表記した。これらの膜は、25°Cの純水250 g に1分間浸した後、送風器(SPRAY-WORK, Basic Air Compressor、株式会社タミヤ)を用いて常温で10秒間乾燥した。水洗の結果を目視で観察したところ、**F**_{ED8} と**F**_{ED16}は溶解したことが分かった。また、**F**_{ED32}の表面には、多くのクラックが観察された。Scheme 1 に、これら の膜の写真を操作順にまとめた。


Scheme 1 Photographs of FED-8, FED16, and FED32, with those films after being rinsed in water.

2-2.5 混合アミン配位子をもつ銅錯体含有プレカーサー膜の形成と紫外光(254 nm)照射によるパターニング Scheme 2 に、本章におけるプレカーサー膜形成と紫外光照射、パターニングと熱処理の実験手順を図示した。 先ず、マイクロピペットを使用して無アルカリガラス基板上に 100 µL のプレカーサー溶液 **S**_Pを滴下した。2-2.4 節 と同様な 2 段階スピンコート法で塗布して 70°C の乾燥器中で 10 分間乾燥して得たプレカーサー膜を **F**₀とした。 その後、**F**₀の端に紫外光シールドとして 5 × 20 mm²の無アルカリガラス基板を載せて、温度が 30~40°C で 湿度が 50~60%のクリーンベンチ内で、強度が 4 mW cm⁻²で波長が 254 nm の紫外光を 2~8 時間照射 した。紫外光照射した膜部分とシールドした膜部分を、それぞれ **F**_xと **F**_{xn} (x = 2, 4, 6, 8) とする。ここで、x は 膜への紫外光照射時間(h) である(以下、特に断らない限り同様に時間単位)。

また,得られたプレカーサー膜を 30~40°C で湿度が 20%のクリーンベンチ内で,強度が 4 mW cm⁻²で波 長が 254 nm の紫外光を 2 h 照射した。得られた膜を **F**_{2-20%}と表記した。

各薄膜を 25°C の純水 250 g に 1 分間浸した後,送風器を用いて常温で 10 秒間乾燥した $F_x \ge F_{xn}$ に対応する各薄膜部分を, $F_{xP} \ge F_{xnP} \ge$ した。これらの薄膜を 1.5 L min⁻¹の Ar 流量中の管状炉内で 400°C で 3 ~5 分間熱処理した。 F_{xP} を熱処理した薄膜を $F'_x \ge$ した。また,ワンポットで合成した S_{P1} を用いて,上記と同様な方法で F'_6 に相当する薄膜を形成した。形成した薄膜は, $F'_{6(one pot)}$ と表記した。



Scheme 2 The schematic representation of the fabrication of the patterned thin films F'_x by using a UV-shielding mask, water rinsing, and heat treatment, where x = 2, 4, 6, and 8 (h).

Scheme 3 は, Scheme 2 によって形成した膜の写真を実験手順ごとにまとめた。



Scheme 3 Photographs of the precursor films (F_0), UV-irradiated and -shielded films (F_x and F_{xn}), F_x and F_{xn} after water-rinsing (F_{xP} and F_{xnP}), and heat treated films (F'_x), where x = 2, 4, 6, and 8 (h).

2-2.6 混合アミン配位子を含む銅錯体含有プレカーサー膜への紫外光(365 nm) 照射

2-2.5 で形成したプレカーサー膜 Fo を温度が 30~40°C で湿度が 50~60%のクリーンベンチ内で, 強度が 5.3 mW cm⁻²で波長が 365 nm の紫外光を4または8h 照射した。紫外光照射された膜を F_{365-xh} (x =4, 8) とする。さらに, 各薄膜を 25°C の純水 250 g に1分間浸した後, 送風器を用いて常温で 10 秒間乾燥した。得られた膜は, F_{365-xhP}と表記した。

2-2.7 紫外光(254 nm)照射で形成した薄膜の光電流密度測定

薄膜の光電流密度は、以下のように作製した作用極を用いる3電極方式で測定した。

マイクロピペットを使用して、100 µL のプレカーサー溶液 **S**_Pを 20 × 20 mm² サイズにマスキングテープ(日 東電工株式会社)でマスキングした FTO 基板上に滴下した。上記 2-2.5 節と同様なスピンコートと乾燥条件でプ レカーサー膜を形成した。温度が 30~40°C で湿度が 50~60 %のクリーンベンチ内で、強度が 4 mW cm⁻²で 波長が 254 nm の紫外光を、プレカーサー膜に 6 時間照射した。形成した膜は **F**_{FTO6}と表記した。マスキングによ って FTO 基板が露出した部分に導線を導電性カーボンテープで固定し、作用極を作製した。

対極(カソード)は面積 15 × 15 mm² の Pt 板とした。参照電極は, 銀-塩化銀電極を用いた。電解液は, 0.1 mmol L⁻¹の硫酸ナトリウム水溶液を使用した。溶液中の溶存酸素を除去するために, 電解液 300 mL に 対して Ar (50 mL min⁻¹)を吹き込みながら測定した。30 min 間暗所下の後, 30 min 間 1 sun 光照射, 30 分間暗所下の順に, 暗所下と光照射中に発生した電流値をソフトウェア(VersaStudio, AMETEK Inc., USA)を用いて記録した。

2-2.8 紫外光照射による原料の銅金属塩の変化

0.516 g (2.285 mmol) のギ酸銅を3.00 g のエタノール中に入れ,5 分間撹拌し,青色沈殿液を調製 した。沈殿を含む 50 μL の溶液を基板上に滴下し,2-2.4 節と同様な2 段階スピンコート法で塗布して 70°C の乾燥器中で 10 分間乾燥した。乾燥したサンプルは **F**_{salt-0} と表記した。**F**_{salt-0} は,温度が 30~40°C で湿度 が 50~60%のクリーンベンチ内で,強度が4 mW cm⁻²で波長が 254 nm の紫外光を 24 時間照射し,**F**_{salt-24} を得た。これらのサンプルの写真を Scheme 4 に示した。



Scheme 4 Photographs of the spin-coated copper formate tetrahydroxide before (\mathbf{F}_{salt-0}) and after $(\mathbf{F}_{salt-24})$ UV-irradiation for 24 h.

2-3 測定結果

2-3.1 薄膜の XRD パターン

図 3 は、基板上に形成した EDTA の銅錯体含有プレカーサー膜(F_{ED0})と紫外光照射した膜(F_{EDx})の XRD パターンを示した。 F_{ED8} と F_{ED16} には、結晶構造に由来するピークは観察されなかった。 F_{ED32} では、20値 が 36.4、43.2、61.2 と 73.7°に 4 本のピークが観察され、それぞれ Cu₂O (ICDD card no. 01-071-3645)の(111)、(200)、(220)と(311)面に帰属できた。



Figure 3 XRD patterns of UV-irradiated films of \mathbf{F}_{EDx} (x = irradiation time = 8, 16, and 32 h). The solid triangle indicates the peaks of Cu₂O crystal phase.

図 4 (a)に、無アルカリガラス基板上の F_0 を、湿度 50~60%で 2~8 時間紫外光照射した膜 F_x の XRD パターンを示す。 F_0 のプレカーサー膜は明確なピークを示さなかった。 F_x では照射時間によらず、30.0、36.8、

42.7, 61.9, 74.1°に5本のピークが観察され, これらのピークはそれぞれ酸化銅(I) (ICDD card no. 01-071-3645)の(110),(111),(200),(220),(311)面に帰属できた。また,湿度20%で2時間紫外光照射した膜 $F_{2-20\%}$ のXRDパターンは、36.8°に弱いピークを示し、酸化銅(I)の(111)面に帰属できた。また、純水洗浄後の F_{xP} のXRDパターンを図4(b)に示す。いずれの場合にも30.0,36.8,42.8,62.0,74.2°に5本のピークを示し、 F_x のピーク位置と比較して高角側の3本のピークが0.1°高角に観察された。また、 F_{4P} のみ12.7°に帰属できないピークが観察された。熱処理した $F'_x \ge F'_{6(one pot)}$ のXRDパターンを図4(c)に示す。



Figure 4 XRD patterns of (a) the precursor film (\mathbf{F}_0), 2 h UV-irradiated film in humidity 20% ($\mathbf{F}_{2-20\%}$), and UV-irradiated films ($\mathbf{F}_{\mathbf{X}}$, $\mathbf{x} =$ irradiation time = 2, 4, 6, and 8 h), (b) irradiated portion of the film after water-rinsing ($\mathbf{F}_{\mathbf{xP}}$), and (c) $\mathbf{F}_{\mathbf{xP}}$ after heat treating at 400 °C for 5 min with an Ar flow of 1.5 L min⁻¹ ($\mathbf{F'}_{\mathbf{x}}$). The peaks assigned to Cu₂O, CuO, Cu, and the unknown crystal phases are denoted with filled diamonds, hollow triangles, hollow diamonds, and a bar, respectively.

すべての **F'**_xと **F'**_{6(one pot)}のパターンおいて, 29.7, 36.6, 42.5, 61.6, 73.8, 77.6°の 6 本のピークが 観察された。これらのピークは, それぞれ酸化銅(I)の(1 1 0), (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0), (3 1 1), (2 2 2)面に帰属できた。 **F'**₄では 43.4°と 50.7°に他と異なるピークが観察され, それぞれ銅(ICDD card no. 00-004-0836)の(1 1 1)と(2 0 0)面に帰属できた。 **F'**₈のパターンには 32.8, 35.6, 39.0, 49.3, 53.6, 58.7, 66.5, 68.3°に 8 本のピークが観察され, それぞれ酸化銅(II)(ICDD card no. 00-041-0254) の(1 1 0), (-1 1 1), (2 0 0), (-2 0 2), (0 2 0), (2 0 2), (-3 1 1), (2 2 0)面に帰属できた。

表 1 には紫外光照射した膜(**F**_x), パターンした膜(**F**_{xP}), とさらに熱処理した膜(**F'**_x)の XRD 測定結 果から, 各膜の酸化銅(I)の(1 1 1)の平均結晶子サイズをまとめた。

Table 1 Average crystallite sizes of Cu₂O in the resultant films of the UV-irradiated film (\mathbf{F}_x), UV-irradiated portions (\mathbf{F}_{xP}) after the water-rinsing treatment, and the ($\mathbf{F'}_x$) samples after further heat-treatment. The values were calculated using the Debye-Scherrer equation on the largest (1 1 1) crystal phase of Cu₂O.

Films	F ₂	F4	F ₆	F ₈	F _{4P}	F _{6P}	F _{8P}	F′ 4	F′ 6	F′8
Crystallite size (nm)	8	8	7	7	8	7	7	12	13	13

図 5 に, プレカーサー膜 **F**₀に 365 nm の紫外光を 4 または 8 h 照射した膜 **F**_{365-4h}と **F**_{365-8h}の XRD パタ ーンを示す。これらのパターンは明確なピークを示さず, いずれも非晶質であることが分かった。



Figure 5 XRD patterns of 365-nm UV-irradiated films F_{365-4h} and F_{365-8h}

図6は、基板上のギ酸銅四水和物と、24時間紫外光を照射した後のXRDパターンを示した。**F**_{salt-0}のXRD パターンは、12.4、16.9、27.1、29.05、31.2、39.55°の6本のピークを示した。**F**_{salt-24}のXRDパターン は、ギ酸銅四水和物 **F**_{salt-0}で観察されたピークに加えて、13.2と26.7°に2本のピークが存在した。これらは、 Cu₂O にも帰属できない不明なピークだった。



Figure 6 XRD patterns of copper formate on Na-free glass substrate before (F_{salt-0}) and after 24 h of UVirradiation ($F_{salt-24}$). Solid triangle indicates unassignable peaks.

2-3.2 膜の吸収スペクトル

図 7 に EDTA の銅錯体含有プレカーサー膜に 8~32 h 紫外光照射した F_{EDx} (x = 8, 16, 32)の吸収 スペクトルを示す。すべての膜は, 深紫外領域に強い吸収を示した。また, F_{ED8}, F_{ED16} と F_{ED32} は, それぞれ 753 と 673, 655 nm の可視光領域に弱いブロードピークを示した。



Figure 7 Absorption spectra of precursor film F_{ED0} and UV-irradiated films F_{EDx} (x = irradiation time = 8, 16, and 32 h). Na-free glass was used as a reference. Each line was represented as F_{ED0} (...), F_{ED8} (---), F_{ED16} (---), and F_{ED32} (---).

図 8 (a)に、 $S_P \ge F_0$ の吸収スペクトルを示す。 $S_P \ge F_0$ は、それぞれ可視光領域の 638 nm と 710 nm にブ ロードピークが観察された。図 8 (b)には紫外光シールドを施した F_{xn} (x = 2, 4, 6, 8)の吸収スペクトルを示 す。30-40°C 中での紫外光照射によって、 F_0 の 710 nm から F_{8n} の 738 nm に時間経過によりピークのシフト が観察された。



Figure 8 Absorption spectra of (a) the precursor solution S_P and preheated film F_0 and (b) UV-shielded portion of the film F_{xn} . Before measuring, S_P was diluted to the Cu²⁺ concentration of 0.005 mmol g⁻¹ by adding ethanol. Ethanol and Na-free glass was used as references for S_P and films, respectively. Each line was represented as S_P (--), F_0 (...), F_{2n} (---), F_{4n} (---), F_{6n} (----), and F_{8n} (---).

図9に, F_x , F_{xP} , F_{xnP} (x = 2, 4, 6, 8) の吸収スペクトルを示す。 F_{xn} から, 730 nm 付近にブロード なピークが観察された一方, 純水洗浄した F_{xnP} の吸収スペクトルの吸光度は約0 だった。しかし, 紫外光照射さ れた F_x では, 500 nm より長い波長の可視光領域において明確なピークは観察されなかった。また, 紫外光照射 後に純水洗浄した F_{4P} , F_{6P} , F_{8P} の吸収スペクトルは, それぞれ洗浄前の F_4 , F_6 , F_8 の吸収スペクトルと一致 した。なお, F_{2P} のみ, F_2 の純水洗浄で吸収強度の減少が観察された。また, 図9 (a)に示した $F_{2-20\%}$ の吸収 スペクトルは, 736 nm にブロードピークが観察された。



Figure 9 Absorption spectra of the UV-irradiated portions of the films (\mathbf{F}_x) and corresponding parts \mathbf{F}_{xP} and \mathbf{F}_{xnP} after the water-rinsing treatment of \mathbf{F}_x and \mathbf{F}_{xn} , respectively. The x-value indicated the UV-irradiation time, (a) x = 2, (b) x = 4, (c) x = 6, and (d) x = 8. Na-free glass was used as a reference. Each line is represented as \mathbf{F}_x (—), \mathbf{F}_{xP} (-·-), and \mathbf{F}_{xnP} (...). Additionally, absorption spectra of 2 h UV-irradiated film in humidity of 20% was shown in (a), represented as $\mathbf{F}_{2-20\%}$ (-··-).

図 10 の **F**_{365-4h}と **F**_{365-8h}では, それぞれ可視光領域の 748 nm と 730 nm にブロードなピークが観察された。水洗で得られた **F**_{365-4hP}と **F**_{365-8hP}は, 可視光領域に吸収帯が観察できなかった。これは水洗によって膜が剥離したためと考えられる。



Figure 10 Absorption spectra of F_{365-xh} and $F_{365-xhP}$ (x = irradiation time = 4 and 8 h). Na-free glass was used as a reference. Each line was represented as F_{365-4h} (---), F_{365-8h} (---), $F_{365-4hP}$ (----), and $F_{365-8hP}$ (----).

2-3.3 プレカーサー膜 Foと紫外光照射した膜 Fxの FT-IR スペクトル

図 11 はプレカーサー膜 **F**₀と紫外光照射した膜 **F**_xの FT-IR スペクトルを示す。無アルカリガラス基板の FT-IR スペクトルには観察されない複数ピークが,(1),(2)と(3)の範囲に観察された。図 11(b)は,範囲(1)をピーク分 離した結果を示した。この範囲(1)のピークは,1621,1573,1558,1514 cm⁻¹の 4 つのピークに分離でき, それぞれ NH₂ 結合の彎曲(Bending)[22],COO⁻結合の非対称性伸縮(Asymmetry stretching) [23],C-N 結合の伸縮[24],とCH₃ 結合の非対称性彎曲に帰属できた[25]。範囲(2)のピークは, CH₂/CH₃ 結合の彎曲に帰属できた[26]。範囲(3)から,CH₃ 基の対称性彎曲(Symmetry bending) [25],COO⁻基の対称性伸縮[23],とC-N 結合の対称性彎曲に帰属できた[26]。また,紫外光照射時間の 延長によって,*こ*れらのピーク強度の減少が確認された。



Figure 11 FT-IR spectra of (a) precursor film F_0 , UV-irradiated film F_x , and Na-free glass substrate, and (b) curve fitting of region (1) of F_0 in the (a) after background correction. Vibration of bonds were assignable to C–N symmetry bending mode, COO⁻ symmetry stretching mode, and CH₃ symmetry bending mode in region (1), CH₂/CH₃ bending mode in region (2), and CH₃ asymmetry bending mode, C–N stretching mode, COO⁻ asymmetry stretching mode in region (3).

2-3.4 F'6の電気的特性と膜厚

ホール効果測定よって評価した F'6 の電気的特性を Table 2 に示す。また他の論文で報告された湿式法で形成 された酸化銅(II)薄膜の電気特性との比較を示す。FE-SEM の断面像より求めた F'6 の膜厚は 90 nm で,抵 抗率を計算する際にこの膜厚値を用いた。今回の方法で得られた酸化銅(I)薄膜のキャリア濃度は,参考文献記 載の結果より 約 10 倍高かった。

Method	Thickness (nm)	Resistivity (Ω cm)	Carrier concentration (cm ⁻³)	Carrier mobility (cm ² V ⁻¹ s ⁻¹)
This work (F' 6)	90	1.4(2) × 10 ²	8(3) × 10 ¹⁶	0.9(3)
MPM* [5]	50	0.8×10^{2}	1.7×10^{16}	4.8
Nebulizer spray pyrolysis method [13]	300-600	1.7 × 10 ³	7.43 × 10 ¹⁵	0.48
Spray-pyrolysis technique [14]	500 ±15	2.2×10^{2}	5.9×10^{15}	4.9

Table 2 Comparison of the electrical properties of the Cu_2O thin film fabricated in this study with those formed using other wet processes. The standard deviations are given in parentheses.

*The previous results of the Cu_2O thin film fabricated by heat-treating a precursor film containing a Cu(II) complex of EDTA, reported by our group in 2012.

2-3.5 Fo, F6, F6PとF'6のFE-SEM 観察結果

 F_0 の断面 SEM 像を図 12 に示した。図 12 から、 F_0 の膜厚が約 650 nm と分かる。6 時間紫外光照射した結果、その膜厚は F_6 の断面 SEM 像から求めたところ、約 160 nm だった。また、その膜を水洗した後、 F_{6P} の断面図の様に約 150 nm の膜厚を示した。 F'_6 の断面図から、膜厚は約 90 nm を示した。 F_6 と F_{6P} の表面図から、粒径が約 50 nm の粒子が観察された。 F'_6 では、表面図から粒径が約 90 nm の粒子が観察された。



Figure 12 Cross-section image of precursor film F_0 whose thickness is ca. 650 nm. Au coating was applied to observe with FE-SEM by increase conductivity.

F6, F6PとF'6の表面と断面 SEM 像を図 13 に示す。



Figure 13 Surface and cross-section images of (a) \mathbf{F}_{6} , (b) \mathbf{F}_{6P} , and (c) \mathbf{F}_{6} . Grain sizes of each films are approximately 50 nm (\mathbf{F}_{6} and \mathbf{F}_{6P}), and 90 nm ($\mathbf{F}_{,6}$). Thicknesses of each films are approximately 160 nm (\mathbf{F}_{6}), 150 nm (\mathbf{F}_{6P}), and 90 nm ($\mathbf{F}_{,6}$). Au coating was applied to observe the FE-SEM image by increasing conductivity.

F'6の AFM 像を図 14 に示す。この AFM 像から, F'6の表面の粗さは約 6 nm と分かった。



Figure 14 AFM image of the heat-treated film, **F**'₆. The roughness of the film was approximately 6 nm, based on the AFM image.

2-3.6 紫外光照射した膜 FFTO6の光電流密度測定

FTO 基板上に形成した F_{FTO6}の光電流密度測定結果を図 15 に示した。測定開始時, F_{FTO6}は約-10 μA の電流値を示し, 測定時間に沿って電流値が-2.7 μA に収束した。1 sun の光を 30 分間照射した結果, F_{FTO6}は約-13~-22 μA の光電流を発生した。



Figure 15 Photocurrent property of F_{FT06} on FTO glass substrate under a dark condition and 1 sun irradiation.

2-4 結果·考察

2-4.1 低温でのプレカーサー膜中の銅(II)錯体の構造変化

プレカーサー溶液 **S**_P の吸収スペクトルで観察された 638 nm の吸収帯は, Cu(II)イオンにアミンの窒素原子 が配位結合した Cu(II) 錯体の d-d 遷移吸収に帰属できた [15]。710 nm に長波長側にシフトした **F**₀ の吸 収スペクトルも d-d 遷移バンドと帰属できた。このピークがレッドシフトする原因は, 配位子になる可能性であるエタ ノールがプレヒートによって除去され, ピークが 638 から 710 nm にシフトした。また, **F**_{xn} の吸収スペクトルが示し たピークも, 紫外光照射時間が 2 から 8 時間に延長したと共に, ピーク位置が 743 nm までレッドシフトした(図 8 (b))。したがって, プレカーサー溶液 **S**_P中に含む Cu(II) 錯体は, プレヒートによって元と違い Cu(II) の化合 物中間体に変化したと考えられる。また, この中間体である Cu(II) 化合物は, 水溶性を持ち, 基板からの水洗 で, 安全なパターニングが可能になった (2-4.3 参照)。

2-4.2 低温での銅(II)錯体の紫外光照射による酸化銅(I)の結晶成長

プレカーサー膜を 30~40°C で 4 mW cm⁻²の低出力な 254 nm 紫外光を照射した部分 **F**_xの XRD パター ンは酸化銅(I)の結晶構造を示した(図 4)。酸化銅(I)の結晶は,わずか 2 時間の紫外光照射で出現したこと が分かる。また,FT-IR スペクトルは,4 時間以上の紫外光照射によって配位子に帰属できる結合が分解されたこ とを示している(図 11)。紫外光は CT 遷移を通して金属錯体を分解できることが知られている [16,17]。したが って,上記の中間体である Cu(II) 化合物も 254 nm の紫外光照射によって CT 遷移を起こし分解したと考えら れる。また,厚さが約 650 nm のプレカーサー膜は紫外光照射によって厚さが約 160 nm まで減少し,粒径約 50 nm の粒子が緻密に繋がる表面状態を形成した。

しかし,365 nm の紫外光で 8 時間照射したプレカーサー膜は,その吸収スペクトルに錯体特有の d-d 遷移に よる吸収帯が観察され,また XRD パターンはピークを示さずに非晶質だった。これらの結果は,254 nm の紫外光 照射はプレカーサー膜中の銅(II)錯体を分解して金属酸化物への転換を起こした一方,365 nm の紫外光照射 は銅(II)錯体を分解できなかったことを示している。

また, 湿度の影響を吸収スペクトルの d-d 遷移吸収帯で比較すると, F2 では観察できず, F2-20%は d-d 遷 移吸収帯が観察された。XRD の結果から, F2 は F2-20%より多く Cu2O の結晶化が観察された。以上のことは, 湿度 50-60%の環境では 20%の環境より Cu2O の結晶ができやすいことを示している。なお, Bretos らは, ·H や・OH のラジカルは, ゾルゲル法で作製されたアモルファス薄膜の結晶化を促進させる可能性があることをが提唱し ている [17]。

チタン酸鉛(PbTiO₃)や鉄酸ビスマス(BiFeO₃)薄膜をゾルゲル法で形成したいくつかの研究は、ゲル膜の結晶化温度が熱処理中の紫外光照射によって低下することを見出した。しかし、室温では、紫外光照射がゲル 膜の結晶化を起こすことはなかった [16,18]。最近 Kim らは、25~28 mW cm⁻²の強度をもち、254 nm が 90%、183 nm が 10%の深紫外線を、いくつかの基板上に形成された 25~35 nm のインジウムガリウム酸 化亜鉛(IGZO)に 30 分間照射した薄膜形成法を報告した。そこでは、130~150°C の窒素雰囲気中で IGZO 薄膜を基板上に堆積させることに成功している [18]。しかし、得られた膜はやはり非晶質だった。

本研究では、エチレンジアミンとプロピルアミンの銅(II)の混合配位子錯体とプロピルアミンの銅(II)錯体を 1:8 の 混合割合で使用した。その結果、酸化銅(I)の結晶は、30~40°C 中で低出力の 4 mW cm⁻²の紫外線を 2 時間照射した薄膜中に出現した。これは、紫外光照射によって Cu(II) 錯体が分解して銅の価数が減少し、かつ 室温で酸化物に結晶化したことを示しており、新たな発見と言える。

2-4.3 銅(II) 錯体からなる固相 Cu2O の形成

Fx 中の酸化銅(I)の結晶は, 錯体中の Cu²⁺が Cu⁺に還元されて生成した。紫外光照射により励起された CT 遷移によって, 配位子から Cu²⁺に電子が供給されて, 配位結合の切断をもたらした。この反応と考えられる形成メ カニズムを Scheme 5 に示す。このメカニズムでは, 銅(II)の EDTA 錯体を含む分子プレカーサー膜を熱処理した 際に形成される金属銅を経由していない [20]。以上の結果から, 紫外光照射による銅(II)錯体から酸化銅(I) 結晶への変換には, 特徴的な CT 遷移吸収端をもつ, アミン配位の銅(II)錯体の構造は必要と分かった。また, 有効な CT 遷移吸収のない金属塩では, 銅(II)化合物から酸化銅(I)に変換できないことが明らかとなった。

本研究室の先行研究では、銅(II)の EDTA 錯体を含むプレカーサー膜を 2 ppm の酸素を含むアルゴンガス気 流中で熱処理すると、Cu²⁺が一旦 Cu⁰ に還元された後、酸化されて Cu⁺に変化して酸化銅(I)の結晶が生成し た [21]。このように、本研究の紫外光によって得た結晶化した酸化銅(I)薄膜形成反応と、先行研究の熱反応 では、生成物は同一でもその反応メカニズムに重要な相違のあることが判明した。



Scheme 5 Possible mechanism of Cu₂O crystal formation from Cu(II) complexes using UV-irradiation.

2-4.4 水を除去剤に用いた酸化銅(I)のパターニング

紫外光照射された F_{2P} は水に溶解し,吸光度が減少した(図9(a))。この吸光度減少は,紫外光シールドを施した F_{2nP} でも同じだった。さらに, F_2 の FT-IR スペクトルは,MPM で調製した金属錯体に特有な水溶性を示し,水洗で膜が剥離した。2hの紫外光照射では,配位子が分解されずに存在するためと考えられる。一方, F_{4P} , F_{6P} , F_{8P} のほとんどは基板に残り,水洗処理前の吸収スペクトルはそれぞれ F_4 , F_6 , F_8 と同様だった。また, F_4 , F_6 , F_8 中の酸化銅(I)の結晶子サイズは,それぞれ F_{4P} , F_{6P} , F_{8P} と一致した。シールドを施した F_{xn} は,約730 nmに銅(II)錯体の中間体のd-d遷移のピークを示した。しかし,水洗処理後の F_{xnP} ではその吸収が観察されなかった(図9)。このように大気中30~40°Cの環境中で,遮蔽シールドと低出力紫外光遮蔽されたの、遮光部分の水洗除去による紫外光照射部分のパターニング酸化銅(I)を作製した。これは紫外光遮蔽された銅(II)の中間体の水への可溶性と、結晶化された酸化銅(I)の不溶性を活用した新たな方法である。

膜の遮蔽部分の溶解性は、適切な溶解液を選択するための重要な要因である。紫外光照射されたゾルゲル膜 は、エタノール [8,9]、メタノール [12]、ヘキサン [12]、アセトン [6,12]、2-メチルアルコール [10]、または プロピオン酸 [11]のような有機溶媒で除去する必要がある。さらに、ゾルゲル法で形成されたゲル膜は、金属と酸 素のネットワークをもつポリマー鎖を含み、これらは加水分解させた固形の生成物として基板に付着している。このよ うに、ゲル膜は原理的に水洗処理になじまない。

一方で、分子プレカーサー法の原理に基づいて調製した錯体を含むプレカーサー膜は、一般に水溶性に富んでいる。したがって、プレカーサー膜の水洗によって基板を回収して再利用することや、プレカーサー溶液の回収も一般 に可能であり、ゾルゲル法と大きく異なる特徴である。

2-4.5 EDTA 配位子, プロピルアミンとエチレンジアミンの混合配位子銅錯体, および銅金属塩, の紫外光照射 による分解

EDTA を配位した銅錯体を含むプレカーサー膜は、室温で 32 時間まで紫外光照射しても、吸収スペクトルに d-d 遷移と考えられる吸収が可視光領域に観察された(図 7)。また、FEDS と FED16 の XRD パターンに、 Cu₂O 結晶に帰属できるピークはなかった(図 3)。一方、FED32 の XRD パターンには、Cu₂O 結晶に帰属でき るピークが現れた(図 3)。また、FEDxをそれぞれ水洗した結果、FED8 と FED16 はほぼ完全に剥離し、FED32 の 表面には多くのクラックが観察された(Scheme 1)。以上の結果から、EDTA を配位した銅錯体の分解は、32 h 以上の紫外光照射が必要と分かる。しかし、32 h の紫外光照射した FED32 においても、不溶性の金属酸化 物の骨格は緻密に形成されずに、水洗時に膜が部分的に溶解して、クラックの多い表面状態になったと推定され る。

一方, 2-4.2 から 2-4.4 までに示したように, プロピルアミンとエチレンジアミンを混合配位した銅錯体は, 2 hの 紫外光照射で有効に分解されて Cu₂O に結晶化した。また, 4 h 以上紫外光照射した膜は, 基板に密着した緻 密な結晶を形成し, 水洗しても膜が基板から剥離しなかった。

以上の実験結果は, EDTA が配位した銅錯体は紫外光による分解が遅く, 金属酸化物への結晶化も困難な 一方, プロピルアミンとエチレンジアミンが混合配位した銅錯体の分解は, 低出力の紫外光照射でも効率的に起こ ったことを示している。

また,原料であるギ酸銅四水和物を紫外光照射した結果,**F**_{salt24}のXRDパターンにピークが観察された。しかし,それらのピークは,紫外光照射前のギ酸銅四水和物のXRDと同様な原料由来のピークと,2本の帰属不能

なピークを示し、いずれも少なくとも Cu₂O には帰属できないピークだった(図 6)。このように、原料塩への紫外光 照射による Cu₂O への転換は不可能で、プロピルアミンとエチレンジアミンが混合配位した銅錯体で可能なことが明 らかになった。

2-4.6 パターン化酸化銅(I)薄膜のアルゴン雰囲気中での熱処理効果

F_{FTO6}の光電流密度値はマイナスで、形成膜がp型半導体として機能したことを示した。また、1 sun に対する 光応答性も示した(図 15)。しかし、熱処理前のパターニング膜 F_{xP} は酸化銅(I)に結晶化していても、半導 体レベルの導電性を示さなかった(図 4 (b))。この低い導電性は、残留する有機化合物の不純物と、低い膜 収縮率によって酸化銅(I)の結晶の密度が低いことに起因している可能性が高い。この仮説は、膜厚が 150 nm の F_{6P} を熱処理し、形成した膜 **F**'₆の膜厚が 90 nm まで減少したことから妥当なことが分かる。

そこで、 F_{xP} を 400°C で 3~5 分間、アルゴン雰囲気中での熱処理を検討した。得られた F'_4 と F'_8 は、それ ぞれ銅と酸化銅(II)の不純物を含み、 F'_6 のみ純粋な酸化銅(I)の結晶構造をもつことが各 XRD パターンから分 かった(図 4 (c))。各不純物の生成は、次のような理由に寄ると考えられる。すなわち、 F_{4P} の熱処理で F'_4 を 得た時には、比較的短時間照射で得た F_{4P} 中に残存した有機化合物が生じた Cu₂O 結晶の一部を還元した。 また、 F_{8P} の熱処理で F'_8 を得た時には、 F_{4P} や F_{6P} の場合より長時間照射で得た F_{8P} 中に残存した有機化合 物の量が少ないために、Cu₂O 結晶がアルゴン中の酸素と容易に反応して酸化された。このように、形成した酸化 銅(I)薄膜中に副生した銅や酸化銅(II)などの不純物が含まれる場合には、 F_{xP} を熱処理し F'_x を形成する時の 還元と酸化の傾向から分かったように、 F_{xP} の有機化合物の量が紫外光照射時間の長いほど減少していた結果か ら合理的に推定できた。なお、熱処理によって、酸化銅(I)の(1 1 1)結晶面のピークを用いて決定した結晶子サ イズが、熱処理前の 7 nm から 13 nm に拡大した(表 1)。

これらの事実に基づき,紫外光照射によって初めて形成した純粋な酸化銅(I)薄膜である F'₆ の電気的性質を 詳細に調べ,次項に記載した。

2-4.7 紫外光照射後に熱処理した酸化銅(I)薄膜 F'6の電気的性質

酸化銅(I)薄膜 F'6と他の湿式法で作製した酸化銅(I)薄膜について,ホール効果測定結果から求めた電気的 性質の比較を表 2 にまとめたように,主なキャリア電荷は正で,薄膜が p 型半導体であることが分かった。このよう に,紫外光照射によってパターニングした p 型半導体酸化銅(I)薄膜の形成にはじめて成功した。

第二章 銅(II) 錯体含有プレカーサー膜への紫外光照射による Cu2O 多結晶薄膜形成とパターン化 -44-

この薄膜の電気抵抗率,キャリア濃度,キャリア移動度は,先に報告された典型的な分子プレカーサー法で形成した薄膜と近い値を示した。しかし, F'6は,先行研究と比べ,約2倍の抵抗率と5分の1のキャリア移動度を示した。この結果は,表面の SEM 像(図 13 (c))から分かるように,膜に生じたピンホールの影響と考えられる。したがって,ピンホールを生じない膜形成法が有効と考えられる。例として,形成した膜上に同様な膜を積層し,ピンホールを満たして,より緻密な表面状態を形成することが考えられる。

2-5 まとめ

空気中 30~40°C 中における低出力の紫外光照射によって、プロピルアミンとエチレンジアミンの混合配位子を もつ銅(II)錯体の膜を結晶性の酸化銅(I)薄膜に変換できた。さらに、紫外光を遮蔽した部分を水洗して、パター ン化した酸化銅(I)薄膜を得た。これらの成果は、分子プレカーサー法のもつ二つの大きな特徴が関わっている。第 ーに、プレカーサー膜が単分散分子量の比較的安定な錯体を含み、ゾルゲル法のように容易には加水分解を起 こさないことである。この特徴は、大規模なポリマーネットワークを再構成する必要がないために、紫外光や低温の 熱処理によって、プレカーサー膜に含まれる錯体が目的とする化合物の結晶核を直接形成可能としている。第二は、 単分散分子量の比較的安定な錯体を含むプレカーサー膜が水に溶解することである。ゾルゲル法で作製した膜では、 これらは原理的に不可能である。このように本研究は、室温で結晶化した薄膜形成を可能とし、さらに水溶解を 利用したパターニングも実現した最初の例である。

また,銅錯体の紫外光照射による膜形成を異なる配位子で比較した結果から,錯体の構造がプレカーサー膜の分解と結晶化に大きく影響することを明らかにした。また,原料塩に紫外光照射した結果は,紫外光照射による銅(II)化合物から酸化銅(I)への変換には,有効な CT 遷移吸収帯をもつ金属錯体の有用性を証明した。

パターンした膜を熱処理した結果,電気抵抗率とキャリア濃度とホール移動度の電気的性質は,それぞれ 1.4(2) × $10^2 \Omega$ cm, 8(3) × 10^{16} cm⁻³, 0.9(3) cm² V⁻¹ s⁻¹であった。以上の結果から,室温環境で パターン半導体薄膜を使用したマイクロスケールの電子デバイスへの応用が期待される。

2-6 参考文献

- [1] Serin, N.; Serin, T.; Horzum, Ş.; Çelik, Y. Annealing effects on the properties of copper oxide thin films prepared by chemical deposition, *Semicond. Sci. Technol.* 2005, 20, 398–401.
- [2] Matsuzaki, K.; Nomura, K.; Yanagi, H.; Kamiya, T.; Hirano, M.; Hosono, H. Epitaxial growth of high mobility Cu₂O thin films and application to p-channel thin film transistor, *Appl. Phys. Lett.* 2008, *93*, 202107.
- [3] Li, B.S., Akimoto, K., Shen, A. Growth of Cu₂O thin films with high hole mobility by introducing a low-temperature buffer layer, *J. Cryst. Growth.* 2009, *311*, 1102–1105.
- [4] Fortunato, E.; Barquinha, P.; Martins, R. Oxide Semiconductor Thin-Film Transistors: A Review of Recent Advances. *Adv. Mater.* 2012, *24*, 2945–2986.
- [5] Nagai, H.; Suzuki, T.; Hara, H.; Mochizuki, C.; Takano, I.; Honda, T.; Sato, M. Chemical fabrication of *p*-type Cu₂O transparent thin film using molecular precursor method, *Mater. Chem. Phys.* 2012, 137, 252–257.
- [6] Blair, S.L.; Hutchins, J.; Hill, R.H.; Bickley, D.G. Solid-state photochemistry of platinum(II) methylazide complexes as thin films on Si (111) surfaces: photolithography of platinum films. *J. Mater. Sci.* 1994, 29, 2143–2146.
- [7] Zhang, J.-Y.; Boyd, I.W. Photo-induced decomposition of platinum metalorganic films for electroless copper plating, J. Mater. Sci. Lett. 1997, 16, 996–998.
- [8] Hattori, A.; Tokihisa, Y.; Tada, H.; Tohge, N.; Ito. S.; Hongo, K.; Shiratsuchi, R.; Nogami, G. Patterning effect of a sol-gel TiO₂ overlayer on the phtocatalytic activity of a TiO₂/SnO₂ bilayer-type photocatalyst. *J. Sol-Gel Sci. Tech.* 2001, *22*, 53–61.
- Que, W.; Jia, C.Y.; Sun, M.; Sun, Z.; Wang, L.L.; Zhang, Z.J. Inorganic Hybrid Sol-Gel Films for Photonic Applications, *Opt. Express.* 2008, *16*, 489–493.
- [10] Lim, H.S.; Rim, Y.S.; Kim, H.J. Photoresist-Free Fully Self-Patterned Transparent Amorphous Oxide Thin-Film Transistors Obtained by Sol-Gel Process. *Sci. Rep.* 2015, *4*, 4544.
- [11] Yoshimoto, Y.; Li, J.; Shimoda, T. Development of a direct patterning method for functional oxide thin films using ultraviolet irradiation and hybrid-cluster gels and its application to thin-film

transistor fabrication, Appl. Phys. Express. 2018, 11, 046501.

- [12] Buono-Core, G.E.; Tejosr, M.; Klahn, A.H.; Cabello, G.; Lucero, A.; Hill, R.H. Solid state photochemistry of Cu(II) alkyltropolonate complexes in thin films: The photochemical formation of high quality films of copper(I) oxide. *J. Chil. Chem. Soc.* 2007, *52*, 1318–1321.
- [13] Prabu, R.D.; Valanarasu, S.; Kulandaisamy, I.; Ganesh, V.; Shkir, M.; Kathalingam, A. Studies on copper oxide thin films prepared by simple nebulizer spray technique, *J. Mater. Sci. Mater. Electron.* 2017, 28, 6754–6762.
- [14] Osorio-Rivera, D.; Torres-Delgado, G.; Márquez-Marín, J.; Castanedo-Pérez, R.; Aguilar-Frutis,
 M.A.; Zelaya-Ángel, O. Cuprous oxide thin films obtained by spray-pyrolysis technique, *J. Mater. Sci. Mater. Electron.* 2018, 29, 851–857.
- [15] Norkus, E.; Stankevičiene, I.; Jagminiene, A.; Prušinskas, K. Cu(II) complex formation with pentaethylenehexamine: Determination of stability constants by the ligand displacement method. *Chemija*. 2011, 22, 131–137.
- [16] Pérez-Mezcua, D.; Sirera, R.; Jiménez, R.; Bretos, I.; DeDobbelaere, C.; Hardy, A.; VanBael, M.K.; Calzada, M.L. A UV-absorber bismuth(III)-N-methyldiethanolamine complex as a low-temperature precursor for bismuth-based oxide thin films, *J. Mater. Chem. C.* 2014, *2*, 8750–8760.
- [17] Bretos, I.; Jiménez, R.; Ricote, J.; Calzada, M.L. Low-temperature crystallization of solution-derived metal oxide thin films assisted by chemical processes. *Chem. Soc. Rev.* 2018, 47, 291–308.
- [18] Calzada, M.L.; González, A.; Poyato, R.; Pardo, L.; Photo-sensitive sol–gel solutions for the lowtemperature UV-assisted processing of PbTiO₃ based ferroelectric thin films. *J. Mater. Chem.* 2003, *13*, 1451–1457.
- Kim, Y.-H.; Heo, J.-S.; Kim, T.-H.; Park, S.; Yoon, M.-H.; Kim, J.; Oh, M.S.; Yi, G.-R.; Noh, Y.-Y.; Park, S.K. Flexible metal-oxide devices made by room-temperature photochemical activation of sol–gel films. *Nature* 2012, 489, 128–132.
- [20] Nagai, H.; Mita, S.; Takano, I.; Honda, T.; Sato, M. Conductive and semi-transparent Cu thin film fabricated using molecular precursor solutions. *Mater. Lett.* 2015, 141, 235–237.
- [21] Nagai, H.; Sato, M.; Molecular Precursor Method for Fabricating *p*-type Cu₂O and Metallic Cu Thin

Films. In *Modern Technologies for Creating the Thin-Film Systems and Coatings*, InTech, 2017, pp. 3–20

- [22] Chandran, A.; Varghese, H.T.; Panicker, C. Y.; Rajendran, G. Oriental Journal of Chemistry 2011, 27(2), 611–617.
- [23] Ito, K.; Bernstein, H. J. Canadian Journal of Chemistry 1956, 31, 170–178.
- [24] Bharathi, N.P.; Khan, N.U.; Shreaz, S.; Hashmi, A.A. J. Inorg. Organomet. Polym. 2009, 19, 558–565.
- [25] Xu, C.-H.; Sun, S.-Q.; Guo, C.-Q.; Zhou, Q.; Tao, J.-X.; Noda, I. Vibrational Spectroscopy 2006, 41, 118–125.
- [26] Kumar, S.; Rathore, D. S.; Garg, G.; Khatri, K.; Saxena, R.; Sahu, S. K. Int. J. Pharm. Pharm. Sci.
 2017, 9(2), 60–68.

第三章

分子プレカーサー法による p 型 Cu₂O 薄膜の形成 と薄膜トランジスタへの応用可能性

3-1 研究背景と目的

テレビや携帯電話は、薄くて軽い綺麗なディスプレイと共に進化し、その発展にはディスプレイを駆動する電子回路の薄膜トランジスタ(TFT)の寄与が大きい。現在、量産されている液晶パネルの多くで使用されている駆動素子は、半導体層にアモルファスシリコン(a-Si)を用いた TFT である。a-Si TFT はスイッチング特性に優れており、 これにより駆動する液晶パネルの用途は、携帯電話やデジタルカメラなどの小型ディスプレイから 30 型を超える大型液晶テレビまで幅広い。一方、半導体層を a-Si から InGaZnO4(IGZO)に置き換えると、電子の移動度が約 20~50 倍程度も高くなることが 2004 年に発見された。これをきっかけに、酸化物半導体を利用する TFT が活発に研究されている。しかし、これまでに報告されているほとんどは、n型酸化物半導体を用いた TFT である。

金属酸化物の価電子帯は,主に酸素の 2p 軌道で構成されており,この 2p 軌道は金属原子の価電子軌道 のエネルギー準位よりも相当低い。このため,酸素原子の 2p 軌道に局在化してホールを生じ難くなり,p 型酸化 物半導体の形成が困難になる。解決方法として,金属原子の価電子軌道のエネルギー準位が酸素 2p 軌道のエ ネルギー準位に近く,イオン状態で価電子軌道が充填された d¹⁰s⁰ の電子配置になり得る金属イオン,Cu⁺, Ag⁺,Cd²⁺,In³⁺,Sn⁴⁺,Sb⁵⁺の選択が最も適切と提唱されている[6,7]。

さらに、安価な金属酸化物を用いて小型電子機器の CPU やメモリーに用いられる CMOS 回路(n 型酸化物 TFT 半導体層とp 型酸化物 TFT 半導体層を相補的に配置した回路)は、省電力で駆動する電子回路として 重要である。しかし、上述したように、組み合わせるp 型酸化物半導体の形成ができないため、CMOS 回路の作 成は難しい。すなわち、CMOS 回路の駆動に必要な 0.1 cm² V⁻¹s⁻¹ 以上の電界効果移動度(ホール移動度) をもつp 型酸化物薄膜の形成が必須である。

2012 年, 化学的湿式法の分子プレカーサー法での *p* 型酸化銅(I)薄膜の形成の最初の論文を当研究室が 発表した[1]。作成した厚さ 50 nm の Cu₂O 薄膜は, ホール効果測定により 4.8 cm² V⁻¹ s⁻¹ の高いキャリア移 動度を示した。本章において, 湿式法である分子プレカーサー法による銅(II)錯体含有プレカーサー膜の熱処理と フォトリングラフィの手法によって, Si/SiO₂ 基板上に *p* 型 Cu₂O-TFT の作成を試みた。

3-2 実験方法

3-2.1 [Cu(H₂EDTA)]·H₂Oの錯体粉末の調製

[Cu(H₂EDTA)]・H₂Oの錯体粉末は、第二章の2-2.2節と同様に調製した。

3-2.2 銅(II)錯体含有プレカーサー溶液の調製

EDTAを配位した銅(II)錯体を含有するプレカーサー溶液は、第二章の2-2.3節と同様に調製した。プロピルア ミンを配位した銅(II)錯体は、スクリュー管ビンに5.00 gのエタノール、2.10 g (9.30 mmol) のプロピルアミンと 2.20 g (37.20 mmol) のギ酸銅四水和物を入れ、室温下1時間撹拌した。成膜用のプレカーサー溶液は、 EDTA配位銅(II)錯体とプロピルアミン配位銅(II)錯体を物質量比で1:8の割合で混合し、銅イオン濃度が0.2、 0.3、0.6 mmol g⁻¹になるように調製した。それぞれの溶液の濃度が分かるように、**S**_{0.2}、**S**_{0.3}と**S**_{0.6}と表記した。

3-2.3 薄膜とTFTの形成

Scheme 1に、本章におけるプレカーサー膜形成と熱処理、パターニングと金蒸着の実験手順を図示した。50 µLの各プレカーサー溶液(**S**_{0.2}, **S**_{0.3}, **S**_{0.6})をシリコン基板上に滴下し、二段階スピンコート法(1st: 500 rpm-5 s, 2nd: 2000 rpm-30 s)で塗布し、70°Cの恒温乾燥器中で10分間乾燥した。乾燥したプレカーサ ー膜を石英管状炉中に入れ、アルゴンガス流量を1.0 L min⁻¹、昇温速度 6°C min⁻¹で室温から 350°C ま で加熱し、それぞれ25、30、70分間熱処理した。得られた3種類の膜を**F**_{0.2}、**F**_{0.3}と**F**_{0.6}と表記した。

TFTへの作成前に、F0.2、F0.3とF0.6はフォトリソグラフィを用いてパターニングした。フォトレジストを3000 rpm-30 s で薄膜上に塗布し、120°Cのホットプレート上で5分間乾燥した。フォトレジストのパターンは、マスクに紫外 線を7.5秒間照射し、現像液中に10分間浸けた後、純水で2回リンスし、さらに120°Cのホットプレート上で2分 間乾燥して形成した。パターンのフォトレジスト付き薄膜をFeCl3浸食液に入れ、露出部が目視で完全に消失まで 浸けた。浸食後、純水で2回リンスし、アセトン中に30秒間浸けて、シリコン基板上にパターン化した膜F0.2P、 F0.3PとF0.6Pを得た。F0.3Pは、再度石英管状炉中に入れ、アルゴンガス流量を1.0 L min⁻¹ にし、昇温速度 17°C min⁻¹ で室温から 350°C までに加熱し、60分および80分間熱処理して、薄膜F0.3PH60とF0.3PH80を 得た。TFTのSource/Drain電極を形成するため、F0.2P、F0.3P、F0.6PとF0.3PH80上に電極パターンマスクを乗 せ、これらのサンプルをスパッターチャンバー内に入れて、アルゴンガス流量 44 sccm と 気圧 0.50 Pa にし、 RFパワー100 W、200秒間でAuをサンプル上に蒸着した。シリコン基板/半導体膜/Au電極の構造で4種類のデ バイスF'0.2P、F'0.3P、F'0.6PとF'0.3PH80を形成した。形成したデバイスの模式構造は、Scheme 2に示した。



Sheme 1 Schematic representation of the sequential process for fabricating the TFT devices.



Sheme 2 Cross-sectional view of the TFT device.

3-3 測定結果

3-3.1 形成した膜のXRDパターン

Figure 1 に、シリコン基板上に形成した膜 F_x(x = 0.2, 0.3, 0.6)、パターン化膜 F_{0.3P}と再熱処理した膜

F_{0.3PHy} (y = 60, 80)の XRD パターンを示す。すべての膜は 29.7, 36.6, 42.4, 61.6, 73.7 と 77.4°の 6 つのピークが観察された。これらのピークはそれぞれ酸化銅(I)(ICDD card no. 01-071-3645)の(1 1 0), (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0), (3 1 1)と(2 2 2)面に帰属できた。また、**F**_{0.3P}から 43.5 と 50.7°のピークが 観察され, それぞれ銅(ICDD card no. 00-004-0836)の(1 1 1)と(2 0 0)面に帰属できた。



Figure 1 The XRD patterns of (a) as-deposited film $F_{0.2}$, $F_{0.3}$, and $F_{0.6}$, (b) patterned film $F_{0.3PH60}$ and secondly heat-treated film $F_{0.3PH60}$ and $F_{0.3PH80}$.

3-3.2 F'_{0.2P}, F'_{0.3P}, F'_{0.6P}とF'_{0.3PH80}のTFTデバイス特性測定

Figure 2 は **F'**_{0.2P}, **F'**_{0.3P}, **F'**_{0.6P} と **F'**_{0.3PH80} の V_D-I_D 曲線を示した。**F'**_{0.2P} の V_D-I_D 曲線は, V_{GS} を +40~-40 V で掃引しても明確に変化しなかった。**F'**_{0.3P}, **F'**_{0.6P} と **F'**_{0.3PH80}の各 on/off 比は, 3.14, 1.28 と 26.5 だった。**F'**_{PH} の μ_{FE} は, 1.89 × 10⁻³ cm² V⁻¹s⁻¹ だった。



Figure 2 The output characteristics of the TFT devices of (a) F'_{0.2P}, (b) F'_{0.3P}, (c) F'_{0.6P}, and (d) F'_{0.3PH80}.

3-3.3 F'0.2P, F'0.3P, F'0.6PとF'0.3PH80のTFTデバイスの表面状態と膜厚

図3は、TFT デバイス F'0.2P, F'0.3P, F'0.6Pと F'0.3PH80の表面 FE-SEM 像を示した。図3から、微小粒子が連続的に繋がりつつ、ボイドを含む形状が観察された。触針段差法によって測定した F'0.2P, F'0.3P, F'0.6PとF'0.3PH80の膜厚は、それぞれ30、40、60と40 nm だった。



Figure 3 The FE-SEM images of TFT devices; (a) F'_{0.2P}, (b) F'_{0.3P}, (c) F'_{0.6P}, and (d) F'_{0.3PH80}.

3-4 結果·考察

3-4.1 銅(II)錯体含有プレカーサー膜を熱処理による p 型 Cu2O TFT の形成

分子プレカーサー法を用いて、銅(II) 錯体含有プレカーサー膜を熱処理して Cu₂O の p 型 TFT を形成した。シリコン基板上に形成した $F_{0.2}$, $F_{0.3}$ と $F_{0.6}$ の XRD パターンは、主に Cu₂O の結晶と微量な不純物として CuO の存在を示した(図 1(a))。 $F_{0.3PH80}$ の XRD パターンは、Cu₂O の単一相であることを示した(図 1(b))。

TFT デバイスとして作成した **F'**_{0.2} の特性測定結果は、V_{GS} の掃引による V_D-I_D 曲線の変化とゲート印加電圧 依存性を示さず、**F'**_{0.2} は TFT デバイスとして機能しないことが分かった(Figure 2(a))。一方、作成した TFT デバイス **F'**_{0.3} と **F'**_{0.6} の特性測定は、いずれも V_{DS} が一定の条件下で、|I_{DS}|は|V_{GS}|の増加とともに増加した (図 2(b)と(c))。以上の結果から、**F'**_{0.3}、**F'**_{0.6} と **F'**_{0.3PH80} は、*p* 型 Cu₂O TFT デバイスとして動作したこと が分かった。

3-4.2 Cu2O TFT デバイスの特性への膜厚による効果

F'_{0.3}と**F'**_{0.6}の on/off 比は, 3.14と1.28 だった。また, V_{DS}とV_{GS}を-40 V の時, **F'**_{0.2}, **F'**_{0.3}と**F'**_{0.6}の I_{DS} はそれぞれ 約-1.21 nA, -0.36 μA と-71.41 μA だった。これらの電流値が膜厚と正比例の関係を示し たことから、**F'**_{0.2}、**F'**_{0.3} と **F'**_{0.6} のシート電気抵抗値と膜厚に反比例すると考えられる。なお、**F'**_{0.2} の SEM 像 は、大量なピンホールが含んた不連続な表面状態が観察され、**F'**_{0.2} はほぼ電気的に絶縁体と考えられる。Oh ら はスパッター法でシリコン基板上に膜厚が 70~100 nm の ZnO の TFT を形成した。TFT の膜厚の上昇によって off 電流が増加し、on/off 比が減少した[2]。以上の結果から、本研究で形成した p 型 Cu₂O の TFT の最適 な膜厚は 40 nm と考えられる。

3-4.3 フォトリソグラフィで形成した薄膜の構造への影響

形成した膜 $F_{0.3}$ の XRD パターンは、Cu₂O と微量な不純物 CuO を含むことを示した。しかし、フォトリソグラフィ でパターン化した膜 $F_{0.3P}$ は、Cu₂O と不純物として Cu を含むことが分かった。この不純物の Cu は、フォトリソグラ フィエ程のエッチングにおいて、Cu₂O とエッチャントが反応したためと考えられる。形成したデバイス $F'_{0.3P}$ は、低い on-off 比の 2.2 を示した。この低い on-off 比の原因は、不純物の Cu が $F'_{0.3P}$ 中の欠陥になったためと考えら れる。また、2 回熱処理した $F'_{0.3PH80}$ は、1 回熱処理した $F'_{0.3P}$ より Cu の含有量が少なく、on-off 比はより 高い値の 26.5 だった。したがって、膜中で欠陥になる Cu の含有量が少ないほど、高い on-off 比を与えると考え られる。

また, **F'0.3PH80**の FE-SEM 像は, ボイドが粒子間に存在することを示した。ボイドは欠陥としてキャリアトラップになり, TFT の電界効果移動度と on-off 比を低下させる原因と考えられる [3–5]。これらのことから, より連続的な表面状態を形成し, かつ金属 Cu を不純物として含まない膜を形成することによって TFT の電気的特性を改善できると考えている。

3-5 まとめ

分子プレカーサー法を用いて、銅(II)錯体含有プレカーサー膜を熱処理し p型 Cu₂Oの TFT を作成した。作成 した Cu₂O の膜厚は 40 nm, 電界効果移動度と on/off 比はそれぞれ 1.89 × 10⁻³ cm² V⁻¹ s⁻¹ と 26.5 だ った。また、TFT の特性曲線は、V_{GS} をマイナス方向に掃引すると、I_{DS} がマイナス方向に増加する現象を示した。 この結果は、分子プレカーサー法による p型 TFT が作成できたことを示しており、初めての成果である。また、フォ トリングラフィのエッチングは、Cu₂O をパターン化すると同時に Cu への還元を引き起こし、パターン化された膜の構 造や組成が変化することも分かった。したがって、第二章で見出した方法のように、浸食液を使用しない、水洗に よる薄膜パターニングが有効と考えられる。

3-6 参考文献

- [1] Nagai, H.; Suzuki, T.; Hara, H.; Mochizuki, C.; Takano, I.; Honda, T.; Sato, M. Chemical fabrication of *p*-type Cu₂O transparent thin film using molecular precursor method, *Mater. Chem. Phys.* 2012, 137, 252–257.
- [2] Oh, B.-Y.; Jeong, M.-C.; Ham, M.-H.; Myoung, J.-M.; Effects of the channel thickness on the structural and electrical characteristics of room-temperature fabricated ZnO thin-film transistors, *Semicond. Sci. Technol.* 2007, 22, 608–612.
- [3] Lee, S.; Ghaffarzadeh, K.; Nathan, A.; Robertson, J.; Jeon, S.; Kim, C.; Song, I.H.; Chung, U.I. Traplimited and percolation conduction mechanisms in amorphous oxide semiconductor thin film transistors, *Appl. Phys. Lett.* 2011, 98, 98–101.
- [4] Nakahagi, T.; Sugiyama, D.; Yukuta, S.; Miyake, M.; Miura-Mattausch, M.; Miyano, S. Modeling of enhanced 1/f noise in TFT with trap charges. *Int. Conf. Simul. Semicond. Process. Devices* 2011, 1, 171–174.
- [5] Liang, Y.; Kyungsoo, J.; Velumani, S.; Cam, P.T.N.; Junsin, Y. Effects of interface trap density on the electrical performance of amorphous InSnZnO thin-film transistor, *J. Semicond.* 2015, *36*, 024007.
- [6] Yanagi, H.; Kawazoe, H.; Kudo, A.; Yasukawa, M.; Hosono, H. *Journal of Electroceramics* 2000, 4, 407.
- Kawazoe, H.; Yanagi, H.; Ueda, K.; Hosono, H. Transparent p-type conducting oxides: Design and fabrication of p-n heterojunctions. *MRS Bullettin* 2000, 25, 28–36.

第四章

チタン(IV)錯体含有プレカーサー膜への 紫外光照射による非晶質薄膜形成と 超親水性 4-1 研究背景と目的

親水性表面コーディングは窓や鏡や壁のような様々な製品にセルフクリーニングや、くもり防止の効果を与える。こ れらの特性を材料表面に与えるために TiO₂ [1-4] や、WO₃ 複合物 [5]、ポリジメチルシロキサン [6]などを表 面コーティングした多数の研究が報告されている。これらの方法の内、化学的に安定で無毒な TiO₂ コーティングは、 原料も豊富なことから多くの研究がある。TiO₂ の光触媒活性は、その結晶構造に依存することが分かっている。一 般に用いられているアナターゼは、紫外光で励起する光半導体であり、紫外光で誘起される親水性を示す。

一方,研究室の Nagai らは, Ti(IV)錯体を含有するプレカーサー膜を熱処理して,酸素欠損ルチル透明薄 膜の作製を報告した [7]。可視光または紫外光を照射した酸素欠損ルチル薄膜上に,1.0 µLの水を滴下したと きの接触角は,各々13(1)°と 5(1)°だった。このように,可視光照射によっても高い親水性が誘起され,かつ紫 外光照射によっても超親水性を示すルチル薄膜が水素処理もなしに形成できることは前例がないだけでなく,大変 な驚きである。分子プレカーサー法の大きな特徴といえる。

分子プレカーサー法(MPM)は、金属錯体の設計を基礎とする方法である。また、プレカーサー溶液は、用いるコーティング法に望ましい溶媒に可溶な金属錯体を含む真溶液である[8]。得られたプレカーサー溶液は、スピンコート法 [7,9] やスプレーコート法 [10] で様々な基板に塗布できる。通常は熱処理によって、均一に基板を覆っているプレカーサー膜から配位子成分を除去して、金属または金属酸化物膜を形成できる。第二章において、混合配位子からなる Cu(II)錯体を含有するプレカーサー膜を用いて、殺菌灯からの紫外光照射により、p型 Cu₂O 半導体薄膜への室温での変換に成功した。水洗によるパターニングも達成した [11]。大気中かつ室温という温

本章では、石英基板上にスピンコートした Ti(IV) 錯体を含むプレカーサー膜への紫外線照射による光誘起超親 水性薄膜の形成を試み、その成果として非晶質透明薄膜の形成とその性質を記載した。

4-2 実験方法

4-2.1 シュウ酸水素ブチルアンモニウム半水和物の合成

プレカーサー溶液は,研究室からの既報を引用して,次のように調製した[12]。シュウ酸 19.6 g (156 mmol) とブチルアミン 11.4 g (156 mmol) を 100 mLのエタノールに加えて,1 時間還流した。その溶液を 室温まで冷却して生じた白色粉末をを減圧ろ過して単離後,一晩風乾させた。

4-2.2 シュウ酸を配位子とするプレカーサー溶液(Sri)の合成

5.00gのエタノール中に, 1.13g(3.96 mmol)のTi(IV)イソプロポキシドと1.37g(7.92 mmol)のシ ュウ酸水素ブチルアンモニウム半水和物を加えて3時間還流した。その後,溶液を室温まで冷却して,0.44g (3.96 mmol)の31%過酸化水素を加えて0.5h還流した。得られたプレカーサー溶液**S**_{Ti}のTi⁴⁺の濃度は 0.4 mmolg⁻¹とした。**S**_{Ti}の外観と溶液が含有するチタン(IV)錯体の予想構造を図1に示した。



Figure 1 Photograph of the precursor solution S_{Ti} , and the possible Ti(IV) complex having oxalato and peroxo ligands is also shown.

4-2.3 プレカーサー膜 Foと254 nm 紫外光照射膜 Fxの形成

Scheme 1 は、本章における薄膜の形成手順を示した。100 µL の S_{Ti}をマイクロピペットで 20 × 20 mm² の石英基板上に滴下した。その後、2 段階スピンコート法(1st:500 rpm で 5 秒、2nd:2000 rpm で 30 秒) でプレカーサー膜を形成し、70°C で 10 分間乾燥した膜を F₀ とする。湿度 40~60%のクリーンベンチ内で、 254 nm の紫外光(強度 4 mW cm⁻²)を F₀上に 1~16 h 照射した。



Scheme 1 The schematic representation of the procedure to fabricate the thin film by using a UV-irradiation for x h (x = 1, 2, 4, 8, and 16)

デジタル温度計で測定した基板表面の温度は,紫外光照射中 30~40°C だった。石英基板上に形成した紫 外光照射膜を F_x (x = 1, 2, 4, 8, 16) とする。この x は紫外光照射時間(h)を意味する。表 1 に F_x の写 真をまとめた。



Table 1 Photographs of F_x before and after contact with water

4-2.4 紫外光照射膜 F4の水中浸漬処理と熱処理

4-2.3 節に形成した F₄は、常温の純水中に 12 h または 70°C の純水中に 2 h 浸漬、または純水中で 15 分間 700 W のマイクロ波照射の 3 種類いずれかの水中浸漬処理を行い、それぞれ F_{4-soaked}、F_{4-boiled} と F₄₋ microwaved を形成した。また、これらの膜と F₄を、30 分間 500°C で空気中熱処理し、それぞれ F_{4-soaked-HT}、 F_{4-boiled-HT}、F_{4-microwaved-HT} と F_{4-HT} を形成した。

4-2.5 プレカーサー膜 Fo に 365 nm の紫外光を 16 時間照射した膜 F365-16

4-2.3 節で形成したプレカーサー膜 **F**₀を温度が 30~40°C で湿度が 50~60%のクリーンベンチ内で, 波長が 365 nm で強度が 5.3 mW cm⁻²の紫外光を 16 h 照射し, 形成した膜を **F**₃₆₅₋₁₆とする。

形成した膜を 25°C の純水 250 g に 1 分間浸した後取り出して,送風機で 10 秒間乾燥した。得られた膜を F_{365-16P}と表記した。
4-2.6 254 nm の紫外光照射膜 FFT016 の光電流密度測定

100 µL のプレカーサー溶液 S_{Ti} を, マイクロピペットで FTO 基板上に滴下した。4-2.3 節と同様なスピンコート と乾燥条件でプレカーサー膜を形成し, 温度が 30~40°C で湿度が 50~60 %のクリーンベンチ内で, 強度が 4 mW cm⁻²の波長 254 nm の紫外光を 4 および 16 h 照射した。紫外光を 4 h 照射した膜は, 水と接触後に 剥離した。一方, 16 h 照射した膜は, 水洗しても膜が基板に密着していた。16 h 照射した膜を F_{FTO16} と表記 する。その光電流密度を, 第二章 2.2-7 節と同様に測定した。

4-3 測定結果

4-3.1 プレカーサー溶液 STiの吸収スペクトル

図 2 に, プレカーサー溶液を 1/40 倍に希釈した溶液の吸収スペクトルを示した。350~550 nm の範囲で中 心波長 377 nm に特徴的な吸収帯が観察された。さらに紫外光領域で強い吸収も観察された。



Figure 2 Absorption spectrum of the diluted solution (Ti^{4+} concentration of 0.01 mmol g⁻¹) of the precursor solution **S**. Ethanol was used as a reference

4-3.2 プレカーサー膜 Foと254 nm 紫外光照射膜 Fxの光学的特性

図3にFoとFxおよび石英基板の透過スペクトルを示す。全ての薄膜FoとFxは、いずれも約275 nmより短波長の紫外光領域光を吸収し、またいずれも可視光領域の透過率は80%を超えた。Fxの屈折率は、1-4.5節

の測定方法により求め、それらの結果を表2にまとめた。



Figure 3 Transmittance spectra of precursor film F_0 , 254-nm UV-irradiated films F_x , and used quartz glass substrate. Air was used as a reference. Each line was represented as the quartz glass plate (---), F_0 (---), F_1 (...), F_2 (---), F_4 (---), F_8 (---), and F_{16} (----).

Table 2 Refractive indices of UV-irradiated films F_x . The standard deviations are provided in parentheses.

Sample	F1	F ₂	F4	F ₈	F 16
Refractive index	1.70(1)	1.79(1)	1.78(1)	1.79(1)	1.79(1)

4-3.3 紫外光照射膜 F4の水中浸漬処理と熱処理した後の透過スペクトル

図 4 (a) に F₄, F_{4-soaked}, F_{4-boiled} と F_{4-microwaved} の透過スペクトルを示す。これらの膜の透過スペクトル に明確な差異はなく, 深紫外線領域での透過率は 0.3%以上で 0 にならなかった。

図 4 (b) に F₄, F_{4-soaked-HT}, F_{4-boiled-HT}, F_{4-microwaved-HT} と F_{4-HT} の透過スペクトルを示す。これら熱 処理膜の可視光領域透過率は、70%以上だったものの、熱処理前より明らかに低下した。また、紫外線領域で は、F_{4-soaked-HT} の透過率は約 0.4 以上とほとんど熱処理前と変わらず、F_{4-microwaved-HT}、F_{4-boiled-HT} と F₄₋



нтはそれぞれ 293、304 と 319 nm の波長以下の透過率は、大きく変化して 0%になった。

Figure 4 Transmittance spectra of (a) thin film after immersion of F_4 into water, that with microwave irradiation, or that with boiling treatment, and (b) those films after additional heat-treatment in air, along with quartz glass. Air was used as a reference.

4-3.4 プレカーサー膜 Foと F365-16, F365-16Pの吸収スペクトル

図 5 に F₀と 365 nm の紫外光を 16 h 照射した膜 F₃₆₅₋₁₆ の吸収スペクトルを示す。F₃₆₅₋₁₆ は,約 350 nm 以下の波長に強い吸収帯と約 370 nm に弱いブロードなピークが観察された。いずれも、水洗して得た F₃₆₅₋₁₆の吸収スペクトルには観察されなかった。



Figure 5 Absorption spectrum of precursor film F_0 , 365-nm UV-irradiated film F_{365-16} and that of film after waterrinsing ($F_{365-16P}$). Air was used as a reference. Each line was represented as F_0 (...), F_{365-16} (—), and $F_{365-16P}$ (---).

4-3.5 プレカーサー膜 Foと 254 nm の紫外光を照射した膜 Fxの XRD パターン

図 6 は、 F_0 と F_x の XRD パターンを示す。石英ガラス基板のハローピーク以外に明らかなピークは観察されなかったので、 F_0 と F_x は非晶質と分かる。



Figure 6 XRD patterns of precursor film F_0 and UV-irradiated films F_x on quartz glass plate.

4-3.6 Fo, Fx と石英ガラス基板の FT-IR スペクトル

図 7 は、石英基板上の F_0 と F_x の FT-IR スペクトルである。 F_0 で観察される 3449 cm⁻¹の弱いブロードな吸 収ピークは化学吸着された水に帰属できる [13]。(a)で観察される 2875, 2934, 2960, 3071 cm⁻¹の弱 いブロードなピークは、CH₂/CH₃基の C-H 結合の伸縮振動に帰属できる [14-16]。(b)で観察される 1675~ 1707 cm⁻¹のピークは、C=O 結合の伸縮振動に帰属できる [17]。(c)で観察される 1382, 1467, 1513 cm⁻¹のピークは、CH₂/CH₃基の C-H 結合のはさみ振動に帰属できる [18-20]。(d)で観察される 1246, 1179 cm⁻¹の 2 つのピークは C-O 結合の伸縮振動に帰属できる [18, 20]。895, 615, 520 cm⁻¹で観察 されるピークは、それぞれサイドオン型ペルオキソ配位 Ti(IV)イオン (Ti-O₂²⁻)の O-O 結合の伸縮振動, Ti-O₂²⁻の対称伸縮振動, とTi-O₂²⁻の非対称伸縮振動に帰属できる [22-24]。また, **F**₁と**F**₂は **F**₀と同じく, (b), (c)と 520 cm⁻¹の位置にピークが観察された。



Figure 7 The IR spectra of F_0 , F_1 , F_4 , F_{16} , and quartz glass substrate. The peaks in each doted region are corresponding to (a) C–H stretching mode, (b) C=O vibration, (c) C–H bending mode, and (d) C–O stretching mode, respectively. The peak at 895 cm⁻¹ is assignable to the O–O stretching mode of Ti–O₂²⁻ bond.

4-3.7 紫外光照射した膜 F4の XPS スペクトル

図8に、F4の XPS スペクトルを示す。図示した5つの領域は、Ti 2p, O 1s, C 1s, N 1s, Si 2p 電子

軌道の結合エネルギーと各々一致する。Ti 2p スペクトルから、459.4と465.1 eV の 2 つの結合エネルギーは、 各々Ti 2p_{3/2}とTi 2p_{1/2}のTi-O 結合に帰属できる。O 1s スペクトルの 528.4と531.0 eV の 2 つの結合エネ ルギーは、酸化チタン(O-Ti)と吸着水のヒドロキシ基(O-H)中に結合した各々の酸素に帰属できる [27,28]。C 1s スペクトルの 281.8と284.5 eV の 2 つの結合エネルギーは、Ti-CとC-C 結合に帰属できる [29,30]。N 1s スペクトルの 400.9 eV は、化学的に吸着された窒素の結合エネルギーに帰属できた [25,31]。 Si 2p_{3/2} スペクトルの 103.6 eV の結合エネルギーは、酸素と結合している Si 2p 軌道の電子のエネルギーに帰 属できた [32]。5 つの元素 Ti, O, C, N, Si の各ピークエリアと感度因子から計算した相対的な割合は、 12.0、53.8、32.5、0.9、0.9%である。また、結合エネルギー528.4 eV の Ti-O 結合について、O/Ti の 比率を計算すると約 1.53 だった。



Figure 8 The XPS spectra of a Ti 2p, O 1s, C 1s, N 1s, and Si 2p of the surface of F_4 . The solid lines indicate the original data of XPS. The dashed and doted curves show theoretically fitted curves by assuming Gaussian distribution.

4-3.8 紫外光照射した膜 Fxの表面状態と膜厚, 密着性試験

図 9 は, F_x (x ≥ 2) の FE-SEM で観察した表面像と断面像を示す。 F_x の表面は, 10~20 nm の微粒 子が緻密に充填しており大きなクラックはなかった。 F_x の断面像は膜と基板の境界が明確で, F_2 , F_4 , F_8 , F_{16} の膜厚は各々約 170, 170, 160, 160 nm と決定できた。鉛筆硬度試験による膜の硬度は, F_1 がF, F_2 , F_4 , F_8 , F_{16} は 6H だった。



Figure 9 The FE-SEM images of top and cross-sectional views of (a) F_2 , (b) F_4 , (c) F_8 , and (d) F_{16} . The thickness of F_2 , F_4 , F_8 , and F_{16} are approximately 170, 170, 160, and 160 nm, respectively.

4-3.9 紫外光照射した膜 Fxの水滴接触角

 F_x に水を滴下したときの画像と接触角を表 3 に示した。10 分間の紫外光照射による光誘起結果と、その後暗所に 0, 1, 2, および 4 h 静置した結果を示す。光誘起前と、石英基板上での接触角を比較対象として表に示した。表 1 に示したように、 F_1 は水を滴下すると表面に亀裂が現れたため、接触角を測定しなかった。

光誘起前の F_x 上の接触角は、石英基板上より大きい。しかし、10 分間の紫外光照射によって、 F_x 上の接 触角は 4°以下に著しく減少した。一方、石英基板は、同様に 10 分間の紫外光を照射しても接触角は変化し なかった。このように、 F_x は光誘起超親水性を示すことが分かった。また、 F_x 上の接触角は、紫外光照射後の暗 所中放置時間に依存して上昇した;すなわち、薄膜形成時に、より長い時間紫外光を照射するほど、より低い 接触角を示した。4 h 暗所静置した膜に再度 10 分間の紫外光を照射したときの接触角は、4°より小さくなった。 このように、4 h の暗所中での静置で親水性レベルが下がった後でも、 F_x に10 分間の紫外光を照射することで、 繰り返し超親水性の現れることが明らかになった。

Table 3 The contact angles of a water droplet on $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$ ($\mathbf{x} \ge 2$) before and after photo-induction by UV-irradiation for 10 min, along with each photograph taken from the side and those on the quartz glass substrate. The measurements were performed after being kept for 0, 1, 2, and 4 h in a dark condition. The contact angles of the photo-induced samples, whose contact angles were once examined after being kept in a dark condition for 4 h, by UV-irradiation again for 10 min are also presented. The standard deviations are given in parentheses.

		Contact angle irradiation for	After re- irradiation with			
Films Before UV- irradiation	0 h	1 h	2 h	4 h	min repeatedly to being kept in a dark condition for 4	
F ₂	62(1)°	4(1)°	8(1)°	16(3)°	23(1)°	2(1)°
F4	53(1)°	3(1)°	9(1)°	14(1)°	21(2)°	3(1)°
F ₈	37(6)°	2(1)°	10(1)°	15(1)°	17(2)°	1(1)°
F ₁₆	31(1)°	2(1)°	5(1)°	10(3)°	14(1)°	2(1)°
Quartz glass	20(1)°	18(2)°				

4-3.10 紫外光照射膜 FFT016 の光電流密度測定

図 10 は、FFT016の光電流密度の測定結果を示した。図 9 (a)は、暗所下と 1sun 光を FFT016 に照射した時の電流はほぼ変化しないことを示した。図 9(b)は、254 nm の紫外光を照射したときの電流変化で、暗所下よりも発生ノイズが強いものの、明確な光電流は確認できなかった。



Figure 10 Photocurrent measurement of UV-irradiation thin film F_{FT016} fabricated on FTO substrate. (a) 1 sun irradiation and (b) germicidal lamp were used as light sources. By the 254-nm intensity detector, (a) is 0.05 mW cm⁻² and (b) is 0.35 mW cm⁻².

4-4 結果·考察

4-4.1 オキサラトとペルオキソ混合配位チタン(IV)錯体を含有するプレカーサー膜

乾燥させたプレカーサー膜 **Fo**は,石英基板上にオキサラトとペルオキソが配位した Ti(IV) 錯体を含有するプレカ ーサー溶液 STiのスピンコートで形成した。STiは、アルキルアンモニウムイオンを対カチオンとする MPM の典型的なエ タノール溶液である。Mehra らは、水溶媒中にチタンの methylenediaminetetracarboxylate (MDTA) 錯 体とMDTAとH2O2が混合配位したチタン錯体を調製して吸収スペクトルを測定し、後者のみが364 nm に吸収 ピークを示す結果を報告した。また, 上記の構造に近いである EDTA と H₂O₂ または cyclohexanediaminetetraacetic acid (CDTA)とH2O2混合配位したチタン錯体の吸収ピークもまとめられ、 それぞれは 365 と 370 nm を示した [33]。本研究で調製した Sriの希釈溶液の吸収スペクトルは 377 nm に ピークをもち, 上記に報告された混合配位したチタン錯体から 7-13 nm 長波長側に吸収ピークがシフトしている。 このシフトは、MDTA、EDTAとCDTAでは配位原子がN2O4型で今回生成している錯体ではO6型の配位原 子であること, かつ溶媒がエタノールのためと考えられる。また, Foの FT-IR スペクトルはサイドオン型の Ti-O2²⁻結 合の存在を示している。したがって,溶存している錯体は,図2に示したようにTi(IV)イオンにO22-イオンが配位し ていると考えられる。Foの透過スペクトルでは約377 nm にペルオキソ配位子と Ti(IV)イオン間の配位結合を観察 できる(図3,7)。さらに、乾燥させたプレカーサー膜中には、FT-IR で示されたように C-O, C=O および CH2/CH3 基の化学結合が含まれる(図 6)。これらの結果から、Fo中にオキサラトとペルオキソ配位子およびブチ ルアミンの存在を明らかである。したがって、同一の溶質を含む乾燥したプレカーサー膜 Fo はプレカーサー溶液中の Ti(IV)錯体のブチルアンモニウム塩からなることが証明できた。

本研究で作成した Ti(IV)錯体のブチルアンモニウム塩を含むプレカーサー膜 **F**₀は、水とエタノールの両方に容易 に溶解するため、**F**₀自身はガラス基板上の親水性材料として使えない。しかし、プレカーサーのこのような溶解性は MPM の大きな利点であり、プレカーサー膜の質が異物などにより十分でない場合には、次の工程の前に基板を回 収して再利用することが可能である。このような利点の他に、MPM は本研究の温和な条件下で、低強度の紫外 光照射によりプレカーサー膜から光誘起親水性薄膜が形成できることは注目に値する(上記参照)。

4-4.2 低強度紫外光照射による Ti(Ⅳ)錯体を含むプレカーサー膜のチタニア薄膜への変換

4 mW cm⁻²の低強度な 254 nm の紫外線は、スピンコートで形成した Ti(IV)錯体からなるプレカーサー膜 F_0 の変換と、形成したチタニア薄膜表面の光誘起親水性の両方で使用した。 **F**₂の FT-IR スペクトルにおいてペルオキソ基のピークが 1 h の紫外光照射で消失したことから, **F**₀中の Ti(IV) 錯体から除去されたことが分かる。さらに, **F**₄, **F**₈と **F**₁₆のスペクトルで示されたように, オキサラトとペルオキソ配位 子の両方に起因するピークは, **F**₀への長時間の紫外光照射により消失することが分かる(図 7)。**F**₀に含まれて いるこれらの配位子は, 紫外光領域の CT 遷移に帰属される強い吸収によって, 室温での紫外光照射によって段 階的に除去されたと考えられる(図 2)。**F**₄ 表面の Ti 2p 軌道に帰属する XPS スペクトルでは, TiO₂ 骨格の Ti⁴⁺-O 結合が観察された(図 8)。しかし, XRD パターンから, すべての紫外光照射膜は非晶質であることが 明らかである。これらの結果は, プレカーサー膜に含まれる Ti(IV)錯体が室温で分解して, 非晶質チタニア(TiO_x (x=1.53))薄膜が形成されたことを示している。x 値は, XPS によって決定した(4-3.7 参照)。

Hattori らは、Ti(OC4H9)4 とベンゾイルアセトンを混合して調製したゲルのメタノール溶液を SnO2 被膜ガラス 基板上にディップコートした。100°C で乾燥後、高圧水銀灯を用いて 350 nm の中心波長をもつ紫外光を照射 して細線パターニングを施し、エタノール洗浄後 500°C で熱処理して結晶性 TiO2 薄膜形成を報告した [34]。 Li らは、シリコン、ガラス、ポリエチレンテレフタレート基板上に N-メチル-2-ピロリドンとメタノールの分散液を用いて、 TiO2粒子をコーティングした結晶性 TiO2 薄膜に、波長が 264 nm で強度が 4.5 mW cm⁻²の紫外光照射に より、室温または 65°C で膜の有機成分の分解を報告した [35]。また Zou らは、テトラブチルチタネート、アセチ ルアセトン、酢酸、および 2-メトキシエタノールの混合物を含む溶液から、Pt/Si 基板上への非晶質 TiO2 薄膜の 形成を報告した。その際、スピンコート膜に、水銀灯(波長 185 および 254 nm、強度 12.5–13.5 mW cm⁻² ²)を用いて、室温で 5 時間照射して形成した。UV 照射中はオゾンが発生し、150°C で 3 分間熱処理する複 雑なプロセスを用いている [36]。

本研究は、室温かつオゾン非共存環境下で、安価な殺菌灯を用いた照射強度 4 mW cm⁻²の 254 nm の みの紫外光を照射して、Ti(IV)錯体を含むプレカーサー膜から前例のない可視光領域で 80%以上の透過率を示 す透明な非晶質チタニア薄膜に変換できることを明らかにした。

4-4.3 アモルファス薄膜の光学的および機械的特性

F₁の可視光領域における透過率は,80%を超える高い値を示した(図3)。F₂, F₄, F₈および F₁₆の屈折 率は1.78~1.79のほぼ同じ値で(図2),2.56の屈折率をもつアナターゼ型 TiO₂の屈折率よりもかなり小さ いフリントガラスに相当する値だった[37]。単層膜の反射率と屈折率の関係は,フレネルの関係式(1)で表す ことができる。

$$\mathsf{R} = \left(\frac{\mathsf{n}_1 - \mathsf{n}_2}{\mathsf{n}_1 + \mathsf{n}_2}\right)^2 \tag{1}$$

ここで, R は膜の反射率, n₁は空気の屈折率を表すので 1 とし, n₂ は膜の屈折率を表す。したがって, **F**₁ の屈 折率は 1.70 で, 他の薄膜の値よりもさらに小さく, 反射率が低いことを示している。

これらの結果は、プレカーサー膜 **Fo**に紫外光を2 h 照射することによって、プレカーサーである Ti(IV)錯体の光 化学反応がほぼ完了したことを示している。前述した FT-IR スペクトルは、1 h 以上の紫外光照射が薄膜中の配 位子を除去するのに適当なことを示している。それ以上の紫外光照射は、非晶質薄膜の緻密化、安定化、およ びスクラッチ強度に寄与していることも明らかになった。

Miyauchiらは、パイレックスガラスまたはシリコンウェハー基板上に、交互積層法(layer by layer assembly) または空気中 673 K の熱処理を使用して、チタン酸水素またはアナターゼ型 TiO₂ ナノチューブフィルムの多結晶 透明ナノチューブ膜形成をそれぞれ報告した [37]。いずれの膜も、屈折率が1.7で、一般的な多結晶アナターゼ 型 TiO₂ 薄膜よりも低い光学反射率と高い透明性を示した。このようなナノチューブ膜の光学的性質は、ナノ構造 からなる多孔性によるものである。その特徴的な形態を形成するためには、強塩基性溶液中での 40 h におよぶ化 学反応を含む多段階で複雑なプロセスにより、また添加した有機ポリマーを分解するために 200 W の Hg-Xe ラン プで 20 h 照射するなどの工程を要した。しかし、本研究では FE-SEM 像から実証したように、緻密な膜構造を維 持し、かつ同等な屈折率をもつ非晶質薄膜を簡便に得ることができた(図 9)。

F₄の深紫外線領域の透過率は, 膜厚が約 170 nm であるにも関わらず, 0%に到達していない。このように, F₄が深紫外線領域で完全に光を吸収できないのは, 膜中に多くのダングリングボンドが存在する非晶質 TiO₂ のた めと予想される。実際, F₄の XPS に多くの OH 結合が検出されたのは, これらのダングリングボンドに由来すると考 えられる。また, F₄を 500°C で熱処理した F_{4-HT}の深紫外線領域での透過率は 0%に達し, より完全な TiO₂ 結晶になったことを示している。このように, 熱処理は非晶質 TiO₂中のダングリングボンドに由来する OH 結合同士 を脱水縮合させた可能性が高い。

一方, F4を水中浸漬しながらエネルギーを与えた後に熱処理した結果, 透過率 0%に達する波長が F4-HTより短波長にシフトした。したがって, 水中浸漬は, OH 結合の安定化に寄与し, 熱処理による脱水縮合を阻害したと考えられる。

4-4.4 アモルファス薄膜の光誘起超親水性

F₂, **F**₄, **F**₈, および **F**₁₆の紫外光照射膜はいずれも光誘起超親水性を示し, これら **F**_xに10 分間の紫外光 照射後の接触角は 30°以上から 4°以下に減少した(表 3)。4 h の暗所静置により各薄膜の親水性レベルが 低下した後でさえ, 膜に再度 10 分間の紫外光を照射すると 4°以下の接触角を有する **F**_xの光誘起親水性の現 れることを実証した。したがって, これらの非晶質薄膜の光誘起親水性は, 結晶性の TiO₂ が示す現象と本質的に 同じと考えられる [38,39]。

TiO₂の光誘起超親水性の原理は、一般的に次の4段階に整理できる。(1)最表面のTiO₂が光を吸収し、 電子ホール対を生成する。(2)生成した電子がTi⁴⁺をTi³⁺に還元すると同時に、生成したホールがO²⁻を酸化し、 そのOが格子から外れて酸素欠損を生成する。(3)TiO₂の最表面で生成した酸素欠損はH₂Oを吸着し易く、吸 着水がOH⁻に置換されて、TiO₂の最表面に水酸基が生成し始める。(4)十分な水酸基が最表面に生成すると、 親水性が発生する。また、暗所放置すると、(2)で生じたTi³⁺がTi⁴⁺に戻り、また(3)で生じたOH⁻が再びO²⁻が 2 つのTi⁴⁺に結合した状態に戻る[43,44]。

また,紫外線照射による超親水性が誘起された後でさえ,多結晶アナターゼ型 TiO₂ 薄膜の接触角は 5°以下 に減少しないことが報告されてきた [37,40]。したがって,本研究で観察された 4°以下の接触角には光誘起以 外の効果も考えられる。膜表面の粗さが親水性を高めるとの報告もあり [37],この観点から考察すると,F₂,F₄, F₈および F₁₆の SEM 像で観察された膜表面の形状も一因と考えられる(図 9)。これら表面に観察されるごく微 細な粒子間の間隙は,光化学反応中に発生した配位子が分解した気体が通過した痕跡と考えられる。このような 空隙がさらに親水性を高めた結果とすると,紫外光照射時間を伸ばすほど接触角が減少した依存性と良く一致す る。

Gao らは、自己組織化単分子層をプレコートされた *p*-Si 基板を室温で水に H₂TiO₃、H₂O₂(H₂O 中 30%)、 アンモニア(H₂O 中 25%)を混合した水溶液中に 120 時間、浸漬することで堆積させたアモルファス TiO₂ 薄膜を 報告した。薄膜上での水滴の接触角は、5 分間の紫外光照射(184.9 と 253.7 nm を中心波長とし、強度 が 1.8 mW cm⁻²)後、34°から 5°以下に変化した。また、親水性喪失後の膜は、1 分間紫外光を照射する と超親水性が発現した [41].また、Vrakatseli らは、チタンイソプロポキシド、イソプロパノール、HNO₃ および H₂O を混合した溶液をガラス及びポリマー基板上にスピンコートして 24 h 室温で暗所静置すると、非晶質 TiO_x 膜が形成できることを報告した。得られた膜は、波長 254 nm で強度 8 mW cm⁻²の紫外光を 7 分間照射する と 5°以下の接触角を示した [42]。本研究は、Ti(IV)錯体を含むプレカーサー膜を用いることによって、室温で 4 hという短時間と4 mW cm⁻²の低強度紫外光照射で,安定な非晶質薄膜を形成可能にした。さらに 4°より 小さい接触角を有する光誘起超親水化を達成した。

4-5 まとめ

室温で 40~60%の湿度中,254 nm の照射ピークの低出力殺菌灯を 4~16 h 使用することで,オキサラト とペルオキソ混合配位の Ti(IV)錯体を含むプレカーサー膜は非晶質の固体薄膜に転換することが分かった。このよう に,MPM で調製したシュウ酸ペルオキソ配位金属錯体は 254 nm の紫外光照射によって効率的に分解した。厚 さが 160~170 nm の非晶質薄膜は,80%以上の高い可視光透明性をもち,アナターゼ結晶膜より格段に小 さな 1.78~1.79 の屈折率で,水接触角が 4°以下になる光誘起超親水性を示した。他の研究で用いられたオ ゾン環境は不要で,室温かつ低強度の市販殺菌灯による 4 h という短時間の紫外線照射で機能性薄膜の形成 が実現した。MPM の概念を活用した液相法で,機能性非晶質薄膜を得るための低コスト,低温かつ単純な成 膜法として,利便性の高さを大きな長所として挙げることができる。

4-6 参考文献

- Fateh, R.; Dillert, R.; Bahnemann, D. Self-cleaning properties, mechanical stability, and adhesion strength of transparent photocatalytic TiO₂-ZnO coatings on polycarbonate. *ACS Appl. Mater. Interfaces* 2014, 6, 2270–2278.
- [2] Latthe, S.; Liu, S.; Terashima, C.; Nakata, K.; Fujishima, A. Transparent, Adherent, and Photocatalytic SiO₂-TiO₂ Coatings on Polycarbonate for Self-Cleaning Applications. *Coatings* 2014, 4, 497–507.
- [3] Adachi, T.; Latthe, S.S.; Gosavi, S.W.; Roy, N.; Suzuki, N.; Ikari, H.; Kato, K.; Katsumata, K. ichi;
 Nakata, K.; Furudate, M.; et al. Photocatalytic, superhydrophilic, self-cleaning TiO₂ coating on cheap,
 light-weight, flexible polycarbonate substrates. *Appl. Surf. Sci.* 2018, 458, 917–923.
- [4] Perkas, N.; Gedanken, A. Coatings of polymers with TiO₂ nanoparticles by sonochemical method. *Tech. Proc. 2011 NSTI Nanotechnol. Conf. Expo, NSTI-Nanotech 2011* 2011, 1, 391–394.
- [5] Miyauchi, M. Photocatalysis and photoinduced hydrophilicity of WO₃ thin films with underlying Pt nanoparticles. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2008**, *10*, 6258–6265.
- [6] Bashir, S.; Bashir, M.; Casadevall, X.; Rees, J.M.; Zimmerman, W.B. Hydrophilic Surface Modification of PDMS Microchannel for O/W and W/O/W Emulsions. *Micromachines* 2015, 6, 1445–1458.
- [7] Nagai, H.; Aoyama, S.; Hara, H.; Mochizuki, C.; Takano, I.; Baba, N.; Sato, M. Rutile thin film responsive to visible light and with high UV light sensitivity. J. Mater. Sci. 2009, 44, 861–868.
- [8] Nagai, H.; Sato, M. Heat Treatment in Molecular Precursor Method for Fabricating Metal Oxide Thin Films. In *Heat Treatment - Conventional and Novel Applications*; Czerwinski, F.; InTech: Rijeka, Croatia, 2012; pp. 297–322.
- [9] Nagai, H.; Sato, M. Molecular Precursor Method for Fabricating *p*-Type Cu₂O and Metallic Cu Thin Films. In *Mod. Technol. Creat. Thin-film Syst. Coatings*; Nikitenkov, N.; InTech: Rijeka, Croatia, 2017; pp. 3–20.
- [10] Hishimone, P.; Nagai, H.; Morita, M.; Sakamoto, T.; Sato, M. Highly-Conductive and Well-Adhered Cu Thin Film Fabricated on Quartz Glass by Heat Treatment of a Precursor Film Obtained Via Spray-

Coating of an Aqueous Solution Involving Cu(II) Complexes. *Coatings* 2018, 8, 352.

- [11] Wu, H.J.; Nagai, H.; Sato, M. Fabrication of a *p*-type Cu₂O thin film via UV-irradiation of a patternable molecular-precursor film containing Cu(II) complexes. *Journal of Crystal Growth* 2019, 509, 112–117.
- [12] Nagai, H.; Mochizuki, C.; Hara, H.; Takano, I.; Sato, M. Enhanced UV-sensitivity of vis-responsive anatase thin films fabricated by using precursor solutions involving Ti complexes. *Sol. Energy Mater. Sol. Cells* 2008, *92*, 1136–1144.
- [13] Guo, X.; Navrotsky, A. Hydration dynamics in zeolite A An X-ray diffraction and infrared spectroscopic study. *Microporous Mesoporous Mater.* 2018, 268, 197–201.
- [14] Sajan, D.; Joe, H.; Jayakumar, V.S.; Zaleski, J. Structural and electronic contributions to hyperpolarizability in methyl p-hydroxy benzoate. J. Mol. Struct. 2006, 785, 43–53.
- [15] Pandiarajan, S.; Umadevi, M.; Rajaram, R.K.; Ramakrishnan, V. Infrared and Raman spectroscopic studies of L-valine L-valinium perchlorate monohydrate. *Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. Spectrosc.* 2005, 62, 630–636.
- [16] Suryanarayanan, C.; Prasannan, A.; Hong, P.Da; Sambathkumar, B.; Somanathan, N. Variable temperature studies on mesogenic polythiophenes using 2D-IR and WAXS. *Mater. Chem. Phys.* 2014, 143, 1352–1363.
- [17] Weisz, A.D.; Garc, L.; Regazzoni, A.E.; Blesa, M.A. FTIR study of the adsorption of single pollutants and mixtures of pollutants onto titanium dioxide in water: oxalic and salicylic acids. *Catalysis Today* 2002, 76, 103–112.
- [18] Kurar, S.; Rathore, D.S.; Garg, G.; Khatri, K.; Saxena, R.; Sahu, S.K. Synthesis and Evaluation of Some Benzothiazole Derivatives As Antidiabetic Agents. *Int. J. Pharm. Pharm. Sci.* 2017, 9, 60–68.
- [19] Xu, C.H.; Sun, S.Q.; Guo, C.Q.; Zhou, Q.; Tao, J.X.; Noda, I. Multi-steps Infrared Macro-fingerprint Analysis for thermal processing of Fructus viticis. *Vib. Spectrosc.* 2006, *41*, 118–125.
- [20] Vogel, E.; Gbureck, A.; Kiefer, W. Vibrational spectroscopic studies on the dyes cresyl violet and coumarin 152. J. Mol. Struct. 2000, 550–551, 177–190.
- [21] Saleh, T.A.; Gupta, V.K. Photo-catalyzed degradation of hazardous dye methyl orange by use of a

composite catalyst consisting of multi-walled carbon nanotubes and titanium dioxide. J. Colloid Interface Sci. 2012, 371, 101–106.

- [22] Ohno, T.; Masaki, Y.; Hirayama, S.; Matsumura, M. TiO₂-photocatalyzed epoxidation of 1-Decene by H₂O₂ under visible light. *J. Catal.* 2001, 204, 163–168.
- [23] Dakanali, M.; Kefalas, E.T.; Raptopoulou, C.P.; Terzis, A.; Voyiatzis, G.; Kyrikou, I.; Mavromoustakos, T.; Salifoglou, A. A New Dinuclear Ti(IV)-Peroxo-Citrate Complex from Aqueous Solutions. Synthetic, Structural, and Spectroscopic Studies in Relevance to Aqueous Titanium(IV)-Peroxo-Citrate Speciation. *Inorg. Chem.* 2003, 42, 110-114.
- [24] Sofetis, A.; Fotopoulou, F.; Raptopoulou, C.P.; Zafiropoulos, T.F.; Perlepes, S.P.; Klouras, N. Reactions of titanocene dihalides with N,N',N"-chelates: Preparation, X-ray structure and characterization of bis(chloro){2,6-bis[(3,5-dimethyl)pyrazol-1-yl]pyridine} (η²-peroxo)titanium(IV). Polyhedron 2009, 28, 3356–3360.
- [25] Xing, M.; Zhang, J.; Chen, F. New approaches to prepare nitrogen-doped TiO₂ photocatalysts and study on their photocatalytic activities in visible light. *Applied Catalysis B : Environmental* 2009, 89, 563–569.
- [26] Jedsukontorn, T.; Saito, N. Photoinduced Glycerol Oxidation over Plasmonic Au and AuM (M = Pt,
 Pd and Bi) Nanoparticle-Decorated TiO₂ Photocatalysts. *Nanomaterials* 2018, *8*, 269.
- [27] Ren, D.; Cui, X.; Shen, J.I.E.; Zhang, Q.U.N.; Yang, X.; Zhang, Z.; Ming, L.U. Study on the Superhydrophilicity of the SiO₂-TiO₂ Thin Films Prepared by Sol-Gel Method at Room Temperature. *Journal of Sol-Gel Science and Technology* 2004, 29, 131–136.
- [28] Baghriche, O.; Rtimi, S.; Pulgarin, C.; Roussel, C.; Kiwi, J. RF-plasma pretreatment of surfaces leading to TiO₂ coatings with improved optical absorption and OH-radical production. *Applied Catal. B, Environ.* 2013, *130–131*, 65–72.
- [29] Chen, X.; Glans, P.; Qiu, X.; Dayal, S.; Jennings, W.D. Smith, K.E.; Burda, C.; Guo, J. X-ray spectroscopic study of the electronic structure of visible-light. *Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena* 2008, 162, 67–73.
- [30] Yang, J.; Bai, H.; Tan, X.; Lian, J. IR and XPS investigation of visible-light photocatalysis-Nitrogen-

carbon-doped TiO₂ film. Appl. Surf. Sci. 2006, 253, 1988-1994.

- [31] Xie, Y.; Li, Y.; Zhao, X. Low-temperature preparation and visible-light-induced catalytic activity of anatase F-N-codoped TiO₂. J. Molecular Catalysis A: Chem. 2007, 277, 119–126.
- [32] Zakaznova-Herzog, V.P.; Nesbitt, H.W.; Bancroft, G.M.; Tse, J.S.; Gao, X.; Skinner, W. Highresolution valence-band XPS spectra of the nonconductors quartz and olivine. *PHYSICAL REVIEW B*, 2005, 72, 205113.
- [33] Mehra, M.C.; Easter, A. Colorimetric Determination of Titanium as Peroxomethylenediaminetetracarboxylate. *Asian J. Chem.* 1997, *9*, 819–823.
- [34] Hattori, A.; Tokihisa, Y.; Tada, H.; Tohge, N.; Ito, S.; Hongo, K.; Shiratsuchi, R.; Nogami, G.
 Patterning Effect of a Sol-Gel TiO₂ Overlayer on the Photocatalytic Activity of a TiO₂/SnO₂ Bilayer Type Photocatalyst. *Journal of Sol-Gel Science and Technology* 2001, *22*, 53–61.
- [35] Li, C.; Colella, N.S.; Watkins, J.J. Low-Temperature Fabrication of Mesoporous Titanium Dioxide Thin Films with Tunable Refractive Indices for One-Dimensional Photonic Crystals and Sensors on Rigid and Flexible Substrates. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 13180–13188.
- [36] Zou, L.; Hu, W.; Xie, W.; Chen, R.; Qin, N.; Li, B.; Bao, D. Applied Surface Science Excellent resistive switching property and physical mechanism of amorphous TiO₂ thin films fabricated by a low-temperature photochemical solution deposition method. *Appl. Surf. Sci.* 2014, *311*, 697–702.
- [37] Miyauchi, M.; Tokudome, H. Low-reflective and super-hydrophilic properties of titanate or titania nanotube thin films via layer-by-layer assembly. *Thin Solid Film* 2006, *515*, 2091–2096.
- [38] Fujishima, A.; Rao, T.N.; Tryk, D.A. Titanium dioxide photocatalysis. *Journal of Photochemistry* and Photobiology C: Photochemistry Review **2000**, *1*, 1–21.
- [39] Nakata, K.; Fujishima, A. TiO₂ photocatalysis: Design and applications. J. Photochem. Photobiol. C Photochem. Rev. 2012, 13, 169–189.
- [40] Eshaghi, A.; Eshaghi, A. Investigation of superhydrophilic mechanism of titania nano layer thin film Silica and indium oxide dopant effect. *Bull. Mater. Sci.* 2012, 35, 137–142.
- [41] Gao, Y.; Masuda, Y.; Koumoto, K. Light-Excited Superhydrophilicity of Amorphous TiO₂ Thin Films Deposited in an Aqueous Peroxotitanate Solution. *Longmuir* 2004, 20, 3188–3194.

- [42] Vrakatseli, V.E.; Pagonis, E.; Amanatides, E; Mataras, D. Photoinduced superhydrophilicity of amorphous TiO_x-like thin films by a simple room temperature sol-gel deposition and atmospheric plasma jet treatment. *J. Phys.: Conf. Ser.* 2014, 550, 012034.
- [43] Fujishima, A.; Rao, T.N.; Tryk, D.A. Titanium dioxide photocatalysis. J. Photochem. Photobiol. C Photochem. Rev. 2000, 1, 1–21.
- [44] Nakata, K.; Fujishima, A. TiO₂ photocatalysis: Design and applications. *J. Photochem. Photobiol. C Photochem. Rev.* 2012, *13*, 169–189.

第五章

非晶質酸素欠損チタニア薄膜によるポリカー ボネート板の表面修飾

5-1 研究背景と目的

ポリカーボネート(PC)板は、安価で耐衝撃性や可視光透過性などの優れた性質によって、道路の屋根や壁、窓などに大量に応用されており、現代社会にとって不可欠な材料である。また、紫外線領域の光をほとんど透過しないために、紫外線のカット材料として使用する例もある [1]。しかし、太陽光または強い紫外線が含まれる光源が長時間 PC 板に照射されると、劣化して変色する [2]。そのような劣化反応が発生しないように、ポリカーボネート板の表面に紫外線をカットする膜の研究も注目されている。

一般に、紫外線をカットする膜として、TiO2が使用される材料の主な一つである。TiO2は、3.1~3.5 eVのバ ンドギャップをもち、紫外線を吸収して光触媒として機能する材料と知られている。また、TiO2 膜は、光化学反応 を起こして表面に吸着した汚れを分解すると同時に、TiO2の最表面が親水化してセルフクリーニングの機能も示す。 このため、TiO2の薄膜が多種な薄膜形成法によって形成し報告された。しかし、PC 板上に薄膜を形成するために は、低温で処理する必要がある。

第四章において、室温下で紫外光照射によるチタン(IV)錯体含有プレカーサー膜から光誘起超親水性を示す 非晶質薄膜を形成した。ガラス基板上に形成した非晶質薄膜は、80%の可視光領域での透過性と 6H の強度 をもち、PC 板上でも紫外線カット膜として適用が期待される。そこで本章では、紫外線を PC 板上に塗布したチタ ン(IV)錯体含有プレカーサー膜に紫外線を照射し、形成した薄膜の超親水性、紫外線カット機能、薄膜の密着 性強度について評価した。

5-2 実験方法

本章で使用するチタン(IV)錯体含有プレカーサー溶液は第四章と同様な方法で調製した。薄膜も,基板以外 は第四章と同様な方法で形成した。面積 20 × 20 mm²と 20 × 40 mm³の PC 板を基板にした。 20 × 20 mm²の基板上に形成した膜は, F_{PCx} (x = irradiation time = 1, 2, 4, 8, 16 h) で表記した。また,面 積 20 × 40 mm²の PC 板の半分(面積 20 × 20 mm²)を,マスキングテープに付けてから第四章と同様 な方法でプレカーサー膜を形成し,同様な光強度と波長でサンプル全体を 24~96 時間紫外光照射した。 照射さ れた膜と基板部分を,それぞれ F_{PCx} と Sub_x (x = irradiation time = 24, 48, 72, 96 h) で表記した。 表 1 に F_{PCx} (x = 1, 2, 4, 8, 16)の写真をまとめた。

F _{PCx}	F _{PC1}	F _{PC2}	F _{PC4}	F _{PC8}	F _{PC16}
Before	Y KOGAKUIN UNIV				
After					
Center of the film after contact with water	Cracked	Cracked	Crack free	Crack free	Crack free

Table 1 Photographs of F_{PCx} before and after contact with water.

5-3 測定結果

5-3.1 紫外光照射した薄膜と基板の透過スペクトル

図1は、 F_{PCx} (x = 1, 2, 4, 8, 16)の透過スペクトルを示す。すべての膜は、可視光領域で80%以上の 透過率を示した。図2(a)は、24~96時間まで紫外光を照射した後の F_{PCx} と Sub_x の透過スペクトルを示す。 F_{PCx} の透過率が0%になる波長は、照射前の300 nm から96時間照射後に322 nm までシフトした。一方、 Sub_x の透過率が0%になる波長は、254 から349 nm まで前後でシフトした。図2(b)は、 Sub_x と F_{PCx} (x = 24, 48, 72, 96 h)の写真をまとめた。



Figure 1 Transmittance spectra of UV-irradiated films on polycarbonate substrate (F_{PCx} , x = irradiation time = 1, 2, 4, 6, and 16 h). Air was used as a reference. Each line was represented as PC substrate (—), F_{PC1} (...), F_{PC2} (---), F_{PC4} (---), F_{PC3} (---), and F_{PC16} (—).



Figure 2 (a) Transmission spectra of F_{PC0} , F_{PCx} (x = 24, 48, 72, and 96 h), and Sub_x , along with PC substrate. Air was used as a reference. F_{PC0} and F_{PCx} were shown as yellow lines, and PC substrate and Sub_x were shown as black lines. Each line was represented as F_{PC0} and PC substrate (---), F_{PC24} and Sub_{24} (...), F_{PC48} and Sub_{48} (----), F_{PC72} and Sub_{72} (---), and F_{PC96} and Sub_{96} (----). (b) The appearances of Sub_x (left) and F_{PCx} (right) after UVirradiation for 24–96 h.

5-3.2 紫外光照射で形成した薄膜の結晶構造

図 3 は, **F**_{PCx}の XRD パターンを示した。基板由来と考えられるブロードピーク以外に明確なピークは観察され ず, すべての薄膜は非晶質と分かる。ただし, 20 が 25~28°と, 40~50°の範囲にも, ブロードな回折線が存 在した。



Figure 3 XRD patterns of UV-irradiated films on PC substrate (\mathbf{F}_{PCx} , \mathbf{x} = irradiation time = 1, 2, 4, 6, and 16 h). No peaks were observed from these patterns.

5-3.3 紫外光照射で形成した薄膜の表面状態とスクラッチ強度

図 4 に F_x (x \geq 4)の表面状態を示す。 F_x の表面は、10~20 nmの大きさの粒子が緻密に繋がって、隙間がなく滑らかなことを示している。肉眼では、 F_x の表面に明確な亀裂は観察できなかった。しかし、低倍率のSEM 像には、多くの亀裂が観察された。

FPC4, **FPC8**, **FPC16**の鉛筆スクラッチ強度試験結果はFで, PC 板は HB だった。



Figure 4 Surface morphologies of UV-irradiated films (a) F_{PC4} , (b) F_{PC6} , and (c) F_{PC16} on polycarbonate substrate, observed with high and low magnification.

5-3.4 紫外光照射で形成した薄膜の接触角実験

表 3 に, F_{PCx} 上に水を滴下したときの画像と接触角を示した。10 分間の紫外光照射によって光誘起させた時 と,その後に暗所で 0, 1, 2,4 h 静置したものを一緒に示した。また,光誘起前と PC 板の接触角を比較対象 として示した。表 1 から分かるように, F_{PC1} と F_{PC2} 上に水を滴下した際に表面に亀裂が現れたため,接触角は測 定しなかった。

10 分間の紫外光照射による光誘起前の F_x 上の接触角は 42°以上だった。しかし, 10 分間の紫外光照射に よって, F_x は接触角が 4°以下の値に大きく減少した。一方, PC 板上では, 同様に 10 分間の紫外光を照射し ても有意な差を示さなかった。これは新たな膜表面が光誘起超親水性をもつことを示し, 10 分間の紫外光照射に よる光誘起後の暗所静置による遮光時間と露出時間が明らかに依存していることも分かる。また, 4 時間暗所静 置された膜に再度 10 分間の紫外光照射したときの接触角は 4°よりも小さくなった。4 時間の暗所静置で親水性 が低下した後でさえ, F_{PCx} に 10 分間の紫外光照射をすることによって, 繰り返し超親水性の発現が明らかになっ た。

Table 3 The contact angles of a water droplet on F_{PCx} ($x \ge 4$) before and after photo-induction by UV-irradiation for 10 min, along with each photograph taken from the side and those on the polycarbonate substrate. The measurements were performed after being kept for 0, 1, 2, and 4 h in a dark condition. The contact angles of the photo-induced samples, whose contact angles were once examined after being kept in a dark condition for 4 h, by UV-irradiation again for 10 min are also presented. The standard deviations are given in parentheses.

Films ir		Contact angles irradiation for 1 2, and 4 h	After re- irradiation with UV-light			
	Before UV- irradiation	0 h	1 h	2 h	4 h	for 10 min repeatedly to being kept in a dark condition for 4 h
F _{PC4}	63(1)°	4(1)°	20(4)°	33(2)°	33(3)°	3(1)°
F _{PC8}	49(6)°	4(2)°	23(2)°	26(2)°	31(2)°	3(1)°
F _{PC16}	42(1)°	5(1)°	18(1)°	22(2)°	30(1)°	4(1)°
PC Sub.	77(1)°	74(1)°				

5-4 結果·考察

5-4.1 低強度紫外光照射によるポリカーボネート板上に Ti(IV)錯体塩を含むプレカーサー膜の非晶質薄膜への 形成

室温下,低強度(4 mW cm⁻²)で254 nmの紫外光をPC 板上のチタン(IV)錯体含有プレカーサー膜に 照射し,光誘起超親水性の非晶質薄膜を形成した。4 時間以上の紫外光照射で形成した膜は,いずれも10 分間の紫外光照射により超親水性を起こした;暗所放置で接触角が上昇し,再び紫外光照射することで超親 水性の再誘起も可能だった。この特性は,TiO2の光誘起超親水性の現象と同じと考えられ,第四章で作成した 膜と同様な現象を示した。しかし、石英ガラス基板上に形成した F4 と PC 板上に形成した FPC4 を比較すると、 FPC4 は暗所放置による接触角の上昇が F4より増大した。

F_{PCx}では, SEM 像から最表面に直線状のクラックが観察された(図 4)。典型的な分子プレカーサー法では, このようなクラックが生じることは稀である。これらのクラックは,基板表面に密着した薄膜の内部応力が残留して,そ の緩和のために生じたと考えられる。実際,プレカーサー溶液の濃度を半減して成膜したところ,ほとんどクラックは生 じなかった。

プレカーサー膜の化学式は、(C4H9NH3)2[Ti(C2O4)2(O2)]に最も近いと考えられる。したがって、紫外光照射によって TiO2が生じるものとして、起こり得る形式的な物質収支は、次式で表される。

 $(C_4H_9NH_3)_2[Ti(C_2O_4)_2(O_2)] \rightarrow TiO_2 + 12C + 24H + 8O + 2N$

この分解反応中は、薄膜内部への空気中からの酸素取り込みは難しいと推定される。その結果、4-4.3 節に 記述したように、紫外光照射によって形成した非晶質 TiO₂は、一部は OH 結合となった多くのダングリーングボン ドが生じた不完全な構造となり、光半導体としてバンドギャップが大きく、かつ光吸収による遷移確率が小さいと考 えられる。このため、深紫外領域での透過率も100%に到達しなかったと考えられる。

5-4.2 FPCx の紫外光カット特性

PC 板と F_{PCx} に、同時に紫外光を 96 h 照射した結果、PC 板の光吸収端が F_{PCx} の光吸収端より可視光領 域までシフトした(図 2)。PC 板の光吸収端のシフトは、紫外光照射による PC 板の劣化反応による変色と考え られる。しかし、 F_{PC96} では光吸収端のシフトは観察されず、PC 板の劣化反応が抑制されたことを示した。また、 図 2(b) の F_{PCx} と Sub_xの写真から、Sub_xが完全に変色した一方、 F_{PCx} は明確な変色を示さなかった。以上 のように、 F_{PCx} が高い紫外光カット性能を有することを確認した。

5-4.3 FPCx の表面状態とスクラッチ強度

第四章では、石英ガラス基板上の F_xの IR スペクトルから、シュウ酸とペルオキソ配位子が 254 nm の紫外光 照射により分解し、2 h以上で固相非晶質薄膜が形成できた。しかし、PC 板上に形成した F_{PCx}では2 hまで 紫外光照射しても、表面が水に接触すると同時に膜にクラックが発生し剥離した(Table 1)。

第二章では、紫外光照射された膜は、水との接触で剥離しなかった。これは、照射により形成した金属一酸素の結合が、基板から膜表面まで酸化物骨格が形成されたためと考えられる。しかし、**F**PCxの表面状態には多くの

クラックが存在し、特に FPC2 は水と接触によって基板から剥離した。また、FPC4、FPC8と FPC16のスクラッチ強度は F だった。以上の結果から、ポリカーボネート板上にチタン(IV)錯体含有プレカーサー膜を紫外光照射による非晶質 薄膜の形成に関して、膜の機械的強度を改善する必要がある。

金属酸化物絶縁体の CeO₂, ZrO₂ と Al₂O₃ は,高い機械的強度をもち,ハードコーディングに応用されている。また,Ce⁴⁺ [3],Zr⁴⁺ [4]と Al³⁺ [5]の遷移金属を TiO₂にドープする例があり,光触媒応答性の改善について報告がある。これらの方法も,PC 上に形成した酸化チタン非晶質薄膜がもつ各性質の改善に効果的と考えられる。

5-5 まとめ

シュウ酸とペルオキソ配位子が混合配位したチタン(IV)錯体含有プレカーサー膜に紫外光を照射して、ポリカーボ ネート板上に非晶質薄膜を室温で形成した。紫外光照射した膜は、光誘起超親水性を示した。96 h 連続的に 紫外光を照射した結果、形成した非晶質薄膜が紫外光を効果的に遮断し、ポリカーボネート板の劣化反応を抑 制した。しかし、SEM 像で観察した多くのクラックが存在し、スクラッチ強度は F だった。膜の機械的な強度だけでは なく、光反応応答性の改善も含めて、Ce⁴⁺、Zr⁴⁺や Al³⁺をドープした非晶質薄膜の形成も有用と考えられる。

5-6 参考文献

- De, G.; Kundu, D. Silver-nanocluster-doped inorganic-organic hybrid coatings on polycarbonate substrates. J. Non. Cryst. Solids. 2011, 288, 221–225.
- [2] Hwang, D.K.; Moon, J.H.; Shul, Y.G.; Jung, K.T.; Kim, D.H.; Lee, D.W. Scratch resistant and transparent UV-protective coating on polycarbonate. *J. Sol-Gel Sci. Technol.* **2003**, *26*, 783–787.
- [3] Li, G.; Liu, C.; Liu, Y. Different effects of cerium ions doping on properties of anatase and rutile TiO₂. *Appl. Surf. Sci.* 2006, 253, 2481–2486.
- [4] Song, J.; Wang, X.; Yan, J.; Yu, J.; Sun, G.; Ding, B. Soft Zr-doped TiO₂ Nanofibrous Membranes with Enhanced Photocatalytic Activity for Water Purification. *Sci. Rep.* 2017, *7*, 1–12.
- [5] Tsai, C.Y.; Kuo, T.H.; Hsi, H.C. Fabrication of Al-doped TiO₂ visible-light photocatalyst for lowconcentration mercury removal. *Int. J. Photoenergy* 2012, 2012, 874509.

第六章

まとめ

6-1 湿式法による機能性膜の形成の現状

現代社会は技術と知識が発展すると共に、その発展から生み出した発明を普及する必要がある。発明の普及に は、民衆が負担できるコストが求められている。しかし、一般的に世界中に使用された電子デバイスまたは特性表 面加工部品は乾式法で作成された。低欠陥で高品質な製品であるものの、真空システムを使用する故に高コスト である。また、乾式法の成膜装置は企業の生産領域では初期投資が大きく、先進国以外での実行はやや難しい と知られている。

湿式法はその低コストとシンプルな方法で多く知られ、より安価な製品の作成法として期待された。しかし、不純物と欠陥由来の低品質は主に知られている。また、一般的に湿式法の工程の中でも、不純物の除去と結晶性の 上昇のために熱処理を使用した。高温成膜の制約によって、形成材料と基板の選択が制限された。低温成膜は、 ミクロスケール以下のデバイスには層と層の拡散を防ぐ、または非耐熱性のポリマー基板使用可能の利点として求め られる。

6-2 紫外光照射による薄膜の形成

本研究の目的として、紫外光照射でプレカーサー膜を金属酸化物膜に転換し、その機能性を評価した。銅 (II)錯体含むプレカーサー膜に紫外光照射により、初めてに室温下でアモルファス膜中の錯体から多結晶 Cu₂O を 形成した。また、成膜の際にマスクしたプレカーサー膜の水溶性を確認し、水のみによる膜のパターニングを初めて達 成した。この方法で形成した Cu₂O 膜は、熱処理後に p 型半導体の電気的特性を示した。以上の結果から、紫 外光照射と水洗による成膜とパターニングが同時に実行でき、より簡単で低コストなパターン膜形成法として期待さ れる。

チタン(IV)錯体含むプレカーサー膜に紫外光照射により,室温下で光誘起超親水非晶質膜を作成した。2時間の紫外光照射で形成した厚さが170 nm の薄膜は,高可視光透過率,低屈折率,高い硬さをもち,暗所 放置後の紫外光照射による超親水化力の再生も確認した。以上の結果から,2 種類の金属イオン種について, いずれも薄膜プレカーサー膜に含まれる金属錯体の電荷移動(CT)遷移を利用して,結晶性または非晶質の金 属酸化物薄膜形成の研究を扱い,形成薄膜の優れた機能を検証できた。

6-3 今後の方針

このように本研究は、室温下における紫外光照射による薄膜形成や、水洗によるパターン化という従来の成膜

概念を超える分子プレカーサー法の新たな特徴を開発できた。また、今後の方針として、多種な金属錯体の設計から、より簡単に紫外光照射で分解できるプレカーサーを調製し、熱処理なしの機能性金属酸化物膜の形成を 目指したい。

研究業績書

I. 審查付論文

番号を付して, 著書名(<u>学位申請者</u>にアンダーライン), 論文名, 学協会誌名, 巻(号), 最初と最後のページ, 発表年(西暦)を記載すること。 **II. その他の研究論文(著書, 学術雑誌, 研究機関への研究報告, 解説など)** 番号を付して, 著書名(<u>学位申請者</u>にアンダーライン), 論文名, 学協会誌名, 巻(号), 最初と最後のページ, 発表年(西暦)を記載すること。 **III. 口頭研究発表** 国外と国内に分けて, 番号を付して, 研究者名(<u>学位申請者</u>にアンダーライン), 学会名, 開催地, 発表年月日を記載すること。 **IV. 学会(委員会関係も含む) および社会における活動状況等** 活動期間と学会, 委員会名を記載すること。 **V. その他の業績(特許・資格・賞罰も含む)** 年月日と業績内容を記載すること。

I. 審查付論文

1. H.-J. Wu, N. Tomiyama, H. Nagai, M. Sato,

Fabrication of a *p*-type Cu₂O thin-film via UV-irradiation of a patternable molecular-precursor

film containing Cu(II) complexes,

Journal of Crystal Growth, 509, 112-117 (2019).

2. H.-J. Wu, K. Tanabe, H. Nagai, M. Sato,

Photo-induced super-hydrophilic thin films on quartz glass by UV irradiation of precursor films involving a Ti(IV) complex at room temperature,

Materials, 12, 348 (2019).

Ⅲ. 口頭研究発表 国内 口頭発表

1. H.-J. Wu, H. Nagai, M. Sato,

Cu₂O Thin-film Fabrication from Cu(II) Complex Having Mixed Ligands by UV-irradiation, The 66th Conference of Japan Society of Coordination Chemistry, Fukuoka, Japan, 2016/9/10-12.

研究業績書

国外 口頭発表

1. H.-J. Wu, H. Nagai, M. Sato,

Patterned Cu₂O Thin-film Fabricated by using UV-irradiation to Molecular Precursor Film Including Cu(II) Complexes,

The 24th International SPACC Symposium, Auckland, New Zealand, 2017/11/22-25.

2. H.-J. Wu, H. Nagai, M. Sato,

Fabrication and Patterning of *p*-type Cu₂O Thin Films by using UV-irradiation to Molecular Precursor Film Including Cu(II) Complexes,

The 8th Advanced Functional Materials and Devices, Belgium, Leuven, 2018/8/18-19.

3. H.-J. Wu, K. Tanabe, H. Nagai, M. Sato,

Super-hydrophilicity of and Amorphous Thin Films Fabricated by UV-irradiation to a Molecular Precursor Film Involving a Ti(IV) complex,

2018 International Symposium on Novel and Sustainable Technology, Tainan, Taiwan 2018/10/4-5.

ポスター発表

1. <u>H.-J. Wu</u>, C.-C. Kao,

Hydrogen Production of Sub-stoichiometric Copper Oxide Thin Film,

Optics & Photonics Taiwan, International Conference 2013, Taoyuan, Taiwan, 2013/12/5-7.

2. <u>H.-J. Wu</u>, C.-C. Kao,

Growth and Hydrogen Production of CIGS Nano-crystals,

The 3rd International Congress on Natural Sciences and Engineering, Kyoto, Japan, 2014/5/7-9.

研究業績書

3. <u>H.-J. Wu</u>, C.-C. Kao,

Influence of Annealing on Physical Properties of Thin Films Containing Nano-sized CIGS, 2014 International Symposium on Nano Science and Technology, Tainan, Taiwan, 2014/10/17-18.

4. H.-J. Wu, H. Nagai, M. Sato,

Fabrication and Characterization of *p*-type Cu₂O Thin Film Transistor by Using Molecular Precursor Method,

The 16th International Symposium on Advanced Technology, Tokyo, Japan, 2017/11/1-2.

V. その他の業績

- 1. The 24th Society of Pure and Applied Coordination Chemistry-CSJ Symposium; SPACC-24th Lecture Award.
- 2. The 16th International Symposium on Advanced Technology; ISAT-16th Poster Award.
- 3. 工学院大学 2018年度 科学教育センター顕彰会 社会貢献活動表彰状 最優秀学生表彰

謝辞

本研究は,博士学位研究として 2016 年 4 月から 2019 年 3 月まで行ったものです。

本研究をまとめるにあたり、熱心な御指導、応援、協力を頂きました工学院大学ナノ・バイオ材料研究室の佐藤光史教授に深く感謝いたします。そして 3 年間日本での研究と生活に多く支援と援助を頂きました永井裕己准教授にも深く感謝いたします。

また,多くの助言と協力を頂いた本田徹教授,尾沼猛儀准教授,山口智広准教授,相川慎也准教授, 望月千尋特任助教,ならびに工学院大学ナノ・バイオ材料研究室の諸先輩方,一緒に研究をした卒業生,修 了生に感謝いたします。

また,本論文を審査して頂いた鷹野一郎教授,大倉利典教授,湯本敦史教授(芝浦工業大学)に感謝 いたします。

最後になりますが、これまで精神的にも、経済的にも支えて応援して下さった家族にも深く感謝します。

本研究は、以上の方々のご尽力を賜り作成したと言っても過言ではありません。ここに心から感謝の意を表します。